证券简称：深南电路　　证券代码：002916

深南电路股份有限公司

Shennan Circuits Co., Ltd.

（广东省深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号）

2026年度向特定对象发行股票

募集说明书

（注册稿）

联合保荐人（主承销商）

国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

中航证券有限公司
AVIC SECURITIES CO., LTD.

（南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层）

二〇二六年十一月

声 明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本募集说明书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下事项。

一、本次向特定对象发行 A 股股票情况

1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过、有权国资监管单位批准、2026 年第二次临时股东会审议通过、第四届董事会第二十次会议审议通过修订，本次发行方案已经深圳证券交易所审核通过**并经中国证监会注册**。

2、本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生分红派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由股东会授权公司董

事会或董事会授权人士和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

4、本次向特定对象发行股票的数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司在董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、股份回购注销等事项引起公司股份变动，则本次向特定对象发行的股票数量将视情况依法做相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

5、本次向特定对象发行股票募集资金不超过 436,735.20 万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金
1	无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目	无锡深南	453,630.84	360,000.00
2	补充流动资金	深南电路	76,735.20	76,735.20
合计			530,366.04	436,735.20

6、本次向特定对象发行完成后，发行对象通过本次向特定对象发行认购的公司股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

7、本次发行前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

8、本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行股票完成后的新老股东共享。

9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31 号）等文件的有关规定，公司制定本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东及公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”之“七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺”之“（三）相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺”。同时，公司提请投资者关注本募集说明书中公司对主要财务指标的假设分析不构成对公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

10、前次募集资金使用情况。公司 2021 年度非公开发行股票募集资金总额为 254,999.99 万元，截至本募集说明书出具日，公司前次募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已注销。

11、公司及其控股股东未向本次向特定对象发行股票的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

二、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险：

1、市场竞争风险

尽管 PCB 行业近年来保持高景气度，但行业参与者众多，市场竞争较为激烈。受益于下游需求快速增长，部分已上市 PCB 企业利用资金优势积极扩充产能，相关产能逐步释放，未来行业竞争可能进一步加剧。报告期内，公司印制电路板业务毛利率分别为 26.55%、31.62%、35.53%和 36.85%，毛利率上升受益于 AI 算力需求快速增长，若未来下游需求增速放缓或不及预期，而新增产能集中投放，行业竞争加剧，可能导致市场逐步发展为买方市场，PCB 产品价格相应

下降，进而对公司毛利率及经营业绩产生不利影响。

2、原材料和设备供应及价格波动风险

公司原材料主要包括覆铜板、半固化片、金盐、油墨和铜箔等。原材料成本占公司产品总成本的比例较高，是公司产品定价的重要影响因素之一。经测算，若原材料成本上涨 10%，本次募投项目达产年平均毛利率将下降 5.14 个百分点。前述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。目前公司原材料采购渠道畅通、供应情况良好，未来若原材料供需结构变化，导致供应紧张或者价格发生波动、交付延迟，将直接影响公司产品正常生产交付，对公司生产经营及盈利能力造成不利冲击。

此外，公司主要生产设备包括钻孔设备、曝光设备、电镀设备及蚀刻设备等。设备的稳定供应及合理定价是保障产能释放、有序生产的重要基础。若未来行业设备供需格局变化、核心设备出现供应短缺、交付滞后或价格大幅上涨等情况，可能会对公司生产经营及持续发展产生不利影响。

3、业绩增速放缓甚至业绩下滑的风险

报告期内，公司实现营业收入 1,352,642.60 万元、1,790,744.53 万元、2,364,697.71 万元和 1,529,636.14 万元，近两年同比增长 32.39%和 32.05%，扣非归母净利润分别为 99,795.39 万元、173,987.26 万元、311,362.75 万元和 223,917.25 万元，近两年同比增长 74.34%和 78.96%，营收与利润均实现快速增长。

未来若下游需求放缓，或出现宏观经济波动、国际贸易环境恶化、行业竞争加剧、客户开拓不及预期、原材料价格大幅波动等情况，均可能导致公司业绩增速放缓，甚至出现业绩下滑的情况。

4、应收款项坏账风险

报告期各期末，公司应收票据、应收账款及应收款项融资账面价值合计分别为 389,547.89 万元、508,206.49 万元、666,914.98 万元和 815,791.46 万元，占流动资产的比例为 45.31%、46.82%、48.84%和 42.31%，应收款项的金额及占比较高。随着公司业务规模的不断扩大，应收款项的增长将加大公司的营运资金周转压力；同时，若宏观经济形势恶化、行业景气度下降，或下游客户经营状

况出现不利变化，导致应收款项无法按期或足额回收，公司可能面临坏账风险，进而对资金周转效率及经营业绩产生不利影响。

5、募集资金投资项目新增产能消化及效益不及预期风险

本次募集资金投资项目主要为现有产品产能扩张。公司已结合当前产业政策、行业趋势、市场环境、技术水平及自身积累的品牌与客户资源等条件，完成审慎的可行性研究论证，项目具备相应的市场基础与业务支撑。但项目建成投产后，若未来市场需求发生不利变化、行业竞争加剧，可能导致新增产能无法充分消化。近年来，PCB 行业景气度较高，下游应用于 AI 算力领域的 PCB 企业加快产能扩张步伐，预计未来数年行业新增产能将集中释放，若行业新增产能投放进度超过下游需求增长速度，将导致市场供给相对过剩，进一步加大本次募投项目新增产能的消化压力。同时，在项目实施与运营全周期内，产业政策调整、技术迭代加速等不确定因素，均可能导致项目实际经济效益不及预期，进而对公司整体经营业绩产生不利影响。

6、募集资金投资项目新增折旧摊销的风险

公司本次募投项目无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目将投入较大金额用于设备采购和工程建设等资本性支出，未来每年新增的固定资产折旧、无形资产摊销对公司经营业绩构成一定影响。根据测算，本次募投项目在项目达产年预计将新增折旧摊销金额 30,560.44 万元，占公司 2025 年利润总额比例为 8.43%，对公司业绩的影响较小。

本次募投项目预期效益良好，项目顺利实施后预计能够有效消化新增折旧摊销的影响，但由于项目建设需要一定的周期，若本次募投项目建设过程中公司经营环境发生重大不利变化，新增折旧摊销可能对本次募投项目效益造成不利影响，继而对公司未来经营业绩产生不利影响。

目录

声　明.....1

重大事项提示.....2

目录.....7

第一节 释义.....10

一、普通术语.....10

二、专业术语.....11

第二节 发行人基本情况.....14

一、发行人基本信息.....14

二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况.....14

三、发行人所处的行业基本情况.....16

四、发行人所处行业竞争情况.....29

五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容.....36

六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略.....42

七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....44

八、同业竞争情况.....48

九、重大未决诉讼、仲裁情况.....50

十、报告期内发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否存在行政处罚、纪律处分.....50

十一、报告期内交易所对发行人年度报告的问询情况.....50

第三节 本次证券发行概要.....51

一、本次发行的背景与目的.....51

二、发行对象及与发行人的关系.....52

三、本次发行方案概要.....53

四、本次发行是否构成关联交易.....56

五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....56

六、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件.....57

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....57

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 58
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 58
二、本次募集资金使用的具体情况 59
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 66
四、募集资金投向与现有业务或发展战略的关系 67
五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式 68
六、关于“两符合”和不涉及“四重大”相关规定 69
七、募集资金使用可行性分析结论 71
八、关于发行人最近五年内募集资金使用情况 71
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 78
一、本次发行完成后，上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况 78
二、本次发行完成后，公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 78
三、本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 79
四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 80
五、本次发行对公司负债情况的影响 80
第六节 与本次发行相关的风险因素 81
一、市场风险 81
二、经营风险 81
三、财务风险 82
四、募集资金投资项目风险 83
五、向特定对象发行股票项目相关风险 84
第七节 与本次发行相关的声明 85
一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 85
二、发行人控股股东声明 94
三、发行人实际控制人声明 95
四、联合保荐人（主承销商）声明 97
五、律师事务所声明 101

六、审计机构声明.....102
七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.....105

第一节 释义

本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语或者词组具有以下含义：

一、普通术语

发行人、公司、深南电路	指	深南电路股份有限公司
本募集说明书	指	深南电路股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票之募集说明书
航空工业集团	指	中国航空工业集团有限公司
深天科技控股	指	深天科技控股（深圳）有限公司，系公司控股股东，曾用名“中航国际控股有限公司”、“中航国际控股股份有限公司”、“深圳中航集团股份有限公司”、“深圳中航实业股份有限公司”
中航产投	指	中航产业投资有限公司
南通深南	指	南通深南电路有限公司
无锡深南	指	无锡深南电路有限公司
天芯互联	指	天芯互联科技有限公司
广州广芯	指	广州广芯封装基板有限公司
深圳广芯	指	深圳广芯封装基板有限公司
无锡广芯	指	无锡广芯封装基板有限公司
泰兴电路	指	泰兴电路有限公司
华进半导体	指	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
上海合颖	指	上海合颖实业有限公司
汇芯通信	指	深圳市汇芯通信技术有限公司
股东会	指	深南电路股份有限公司股东会
董事会	指	深南电路股份有限公司董事会
监事会	指	深南电路股份有限公司原监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
LME	指	伦敦金属交易所（London Metal Exchange）

《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	发行人现行公司章程
《注册管理办法》	指	上市公司证券发行注册管理办法
《证券期货法律适用意见第 18 号》	指	《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
保荐机构、保荐人、主承销商	指	国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司
审计机构、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年 1-6 月
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日、2026 年 6 月 30 日
报告期末、最近一期末	指	2026 年 6 月 30 日

二、专业术语

印制电路板	指	印制电路板（Printed Circuit Board，简称 PCB），又称印刷电路板、印刷线路板，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板
PCBA、电子装联	指	Printed Circuit Board Assembly 的简称，指 PCB 板级、模组及系统级装联，即 PCB 裸板经过 SMT 上件，再经过 DIP 插件的整个制程
封装基板	指	又称 IC 载板，直接用于搭载芯片，可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热等功效，以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性或多芯片模块化等目的
CPCA	指	中国电子电路行业协会（China Printed Circuit Association）
EMS	指	电子制造服务商（Electronics Manufacturing Service），为提供一系列服务的代工厂商
背板	指	用于连接或插接多块单板以形成独立系统的印制电路板
金属基板	指	由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制线路板
厚铜板	指	使用厚铜箔（铜厚在 3 oz 及以上）或成品任何一层铜厚为 3 oz 及以上的印制电路板
高频微波板	指	采用特殊的高频材料进行加工制造而成的印制电路板
刚挠结合板	指	刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求
HDI	指	高密度互连（High Density Interconnection）
IC	指	集成电路（Integrated Circuit），是一种微型电子器件或

		部件。采用一定工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
CPU	指	Central Processing Unit 的缩写，中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是电子产品的运算核心和控制核心
GPU	指	Graphics Processing Unit 的缩写，即图形处理器，广泛应用于图形渲染、并行计算、人工智能训练及推理等高性能计算场景
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的缩写，即专用集成电路，是应特定应用场景需求专门设计和制造的集成电路
I/O	指	Input/Output，即输入/输出
交换机	指	基于以太网进行数据传输的多端口网络设备，每个端口都可以连接到主机或网络节点，主要功能就是根据接收到数据帧中的硬件地址，把数据转发到目的主机或网络节点
路由器	指	路由器（Router）是连接因特网中各局域网、广域网的设备，它会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径按前后顺序发送信号。路由器已经广泛应用于各行各业，各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军
AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，人工智能
Prismark	指	美国 Prismark Partners LLC，印制电路板行业权威咨询机构
TrendForce	指	集邦咨询，全球知名的科技产业市场专业研究机构，提供半导体等领域的行业研究分析及数据报告
FC	指	倒装（Flip-Chip），是指在 I/O pad 上沉积锡铅球，然后将芯片翻转加热利用熔融的锡铅球与陶瓷基板相结合
CSP	指	芯片级封装（Chip Scale Package），又称芯片尺寸封装
UBB	指	Universal Baseboard 的缩写，通用基板
OAM	指	Open Accelerator Module，承载 GPU 或其他 AI 加速芯片的核心板卡
BGA	指	焊球阵列封装（Ball Grid Array），指在封装体基板的底部制作阵列焊球作为电路的 I/O 端与印刷线路板互接
mSAP	指	改良半加成法，一种 PCB 生产方法，相较于传统的减成法，能够制造出更佳的线路与间距
WB	指	引线键合（Wire Bonding），使用细金属线，利用热、压力、超声波能量使金属引线与基板焊盘紧密焊合，实现芯片与基板间的电气互连和芯片间的信息互通
SMT	指	表面组装技术（Surface Mount Technology），电子组装行业里常用的一种技术和工艺
PNL	指	板数（Panel），是公司封装基板的计量单位
CCL	指	Copper Clad Laminate 的缩写，覆铜箔层压板、覆铜板

CAGR	指	复合年均增长率，Compound Annual Growth Rate 的缩写
OTN	指	光传送网（Optical Transport Network），是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网，是下一代的骨干传送网
OLT	指	光线路终端（Optical Line Terminal）是光接入网的核心部件，相当于传统通信网中的交换机或路由器，同时也是一个多业务提供平台
ONU	指	光网络单元（Optical Network Unit）是光网络中的用户端设备，放置在用户端，与 OLT 配合使用，实现以太网二层、三层功能，为用户提供语音、数据和多媒体业务

注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致

第二节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	深南电路股份有限公司
英文名称	Shennan Circuits Co., Ltd.
股票简称	深南电路
股票代码	002916
股票上市地	深圳证券交易所
成立日期	1984 年 7 月 3 日
上市日期	2017 年 12 月 13 日
注册资本	**681,133,995** 元
法定代表人	杨智勤
统一社会信用代码	914403001921957616
注册地址	深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号（一照多址企业）
电话	86-755-89300000
传真	86-755-89308100
电子邮箱	contactus@scc.com.cn
公司网址	http://www.scc.com.cn/
经营范围	经营范围：印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备的研制、生产、加工、服务、销售；工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED 产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售；电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技术咨询、物业管理、计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：经公司股东会审议通过，部分激励对象因离职不再符合激励条件，公司按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的合计 3.26 万股限制性股票进行回购注销。截至本募集说明书出具日，相关回购注销手续已办理完毕，公司总股本减少至 681,133,995 股。

二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）公司股本结构和前十大股东持股情况

1、公司股本结构

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人股本结构情况如下：

股份类别	股份数量（股）	比例
一、有限售条件股份	16,145,388	2.37%
二、无限售条件股份	665,021,207	97.63%
合计	**681,166,595**	**100.00%**

2、公司前十名股东持股情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十名股东及其持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数（股）	持有有限售条件股份数（股）	股权质押冻结情况	
					股份状态	股份数量（股）
深天科技控股	国有法人	62.61%	426,489,271	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2.71%	18,434,175	-	-	-
平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.03%	7,034,753	-	-	-
中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	其他	0.53%	3,583,950	-	-	-
富国基金管理有限公司－社保基金 2101 组合	其他	0.47%	3,186,919	-	-	-
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.44%	2,967,866	-	-	-
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	其他	0.33%	2,240,264	-	-	-
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.30%	2,037,325	-	-	-
中航产业投资有限公司	国有法人	0.27%	1,811,929	-	冻结	1,811,929
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.25%	1,668,957	-	-	-

（二）公司控股股东和实际控制人基本情况

1、公司控股股东情况

截至 2026 年 6 月 30 日，深天科技控股持有公司 426,489,271 股股份，占公司股份总数的 62.61%，为公司控股股东。

2、实际控制人情况

截至 2026 年 6 月 30 日，航空工业集团通过深天科技控股及中航产投间接合计控制公司 62.88%股份，为公司实际控制人。

3、控股股东、实际控制人股份质押、冻结或潜在纠纷的情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东一致行动人中航产投持有的公司 0.27%股份已被司法冻结，相关冻结股份情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	冻结股数	冻结股数占发行人总股本比例
1	中航产投	1,811,929	0.27%	1,811,929	0.27%
合计		**1,811,929**	**0.27%**	**1,811,929**	**0.27%**

除此之外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份不存在质押、冻结等其他权利限制的情形。上述冻结的股份数量较少，不会对发行人实际控制权稳定构成重大不利影响。

三、发行人所处的行业基本情况

（一）公司所处行业概况

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”之“电子电路制造”，行业代码为 C3982。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”项下的“新型电子元器件及设备制造”行业。

（二）行业主管部门和监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门

工信部是 PCB 行业的主管部门，负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准

并组织实施，指导行业质量管理工作等。

2、行业自律性协会

中国电子电路行业协会是我国 PCB 行业的自律组织，系由电子电路（PCB）、覆铜箔板（CCL）、原辅材料、专用设备及电子装联（SMT）和电子制造服务（EMS）企业以及相关科研院校自愿结成的全国性、行业性社会团体。中国电子电路行业协会下设六个二级分会，现有会员单位超过 1,000 家。CPCA 立足“引领、专业、平台、服务、规范”，服务政府、服务会员、服务社会，在产业发展、行业研究、标准制定、技术交流、展览展示、刊物出版、人才培养、国际交流等方面积极开展工作。

3、行业主要法律法规和政策

电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，印制电路板作为电子信息产业的核心基础组件，受到国家政策的大力扶持。国家相继推出了一系列扶持和鼓励印制电路板行业发展的产业政策，从而推进行业的产业升级及战略性调整。近年来，我国出台的支持相关产业发展的重大政策具体如下：

序号	发布时间	产业政策	发布/编制单位	相关产业政策
1	2026 年 3 月	《政府工作报告》	国务院	培育壮大新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业
2	2026 年 3 月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	国务院	聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破
3	2025 年 11 月	《印制电路板行业规范条件（2025 年本）》（征求意见稿）	工信部	进一步加强印制电路板行业管理，促进行业高质量发展，引导产业转型升级和结构调整，推动印制电路板产业持续健康发展
4	2025 年 8 月	《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》	工信部、国家市场监督管理总局	完善电子信息制造业高新技术企业、科技和创新性中小企业、瞪羚企业、独角兽企业等优质企业梯度培育体系；强化关键核心技术攻关，提升重点产业链供应链韧性和安全水平，通过集成应用牵引，提高系统整体能力，提升元器件、零部件等产品可靠性、安全性

序号	发布时间	产业政策	发布/编制单位	相关产业政策
5	2025 年 4 月	《电子信息制造业数字化转型实施方案》	工信部、国家发改委、国家数据局	提高电子信息制造业数字化、网络化、智能化水平，推动生产方式和组织形态变革，加快电子信息制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展，为推进新型工业化、建设现代化产业体系提供有力支撑
6	2023 年 8 月	《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》	工信部、财政部	支持龙头企业做大做强，持续发挥引领支撑效应。鼓励龙头骨干企业围绕主营业务方向，与创新型中小微企业、高等院校、科研机构和各类创客群体有机结合、形成规模。围绕产业上下游及存在共性技术的相关领域，培育和吸引一批专注细分市场、丰富产业链体系的优势企业

（三）行业发展概况

1、行业发展概况

（1）印制电路板（含封装基板）行业发展情况

印制电路板是指在覆铜板上按照预定设计形成铜线路图形的电路板，其主要功能是使各种电子零组件按照预定电路连接，起电气连接作用。封装基板与 PCB 制造原理相近，是 PCB 适应电子封装技术快速发展而向高端技术的延伸，两者存在着一定的相关性。封装基板作为一种高端的 PCB，是芯片封装不可或缺的一部分，不仅能够为芯片提供支撑、散热和保护作用，也为芯片与 PCB 母板之间提供电气连接。

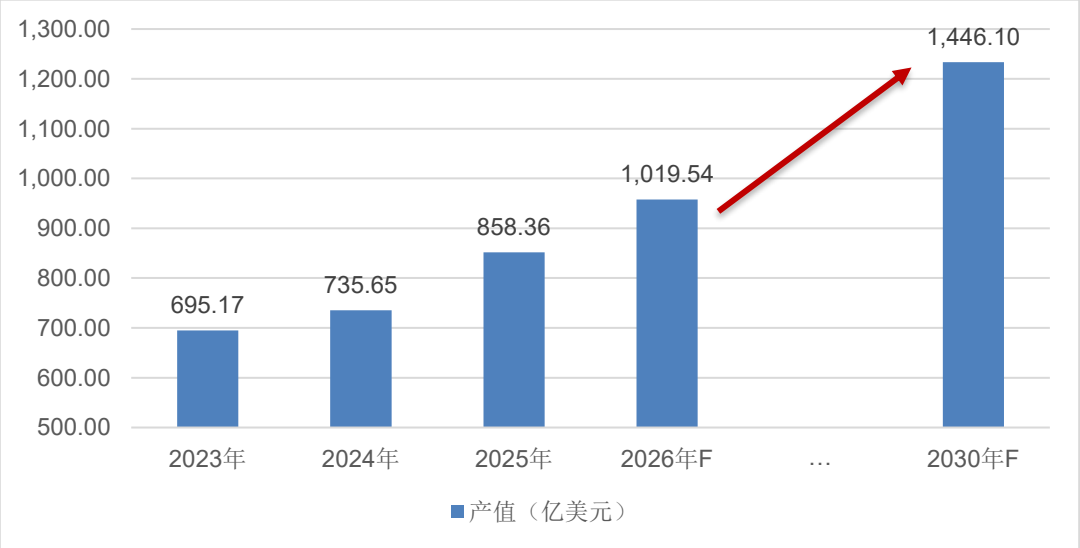
印制电路板（含封装基板）是承载电子元器件并实现电气互连的核心基础部件，具有应用领域广泛、定制化程度高、技术与资金密集等行业特征，行业景气度与下游电子系统市场高度相关。近年来，受宏观经济波动及通信、消费电子需求变化影响，行业经历了阶段性调整；2024 年以来，在 AI 算力基础设施爆发式增长的驱动下，行业进入新一轮高景气上行周期，产品结构持续向高端化、高附加值方向升级，全球产能进一步向以中国大陆为核心的亚洲区域集中。PCB 下游覆盖服务器/数据存储、通信、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子等众多领域，市场需求空间广阔。

1）全球 PCB 市场空间广阔，AI 驱动行业进入新一轮高景气周期

印制电路板是电子信息产业的核心基础组件，其所属行业为全球电子元件细分领域中产值占比最高的细分行业。近年来，受国际地缘政治形势复杂多变、全球宏观经济波动及通信、消费电子下游需求放缓等因素叠加影响，全球 PCB 行业经历阶段性调整。2024 年以来，随着 AI 推动服务器及数据存储、高速网络设备等算力基础设施爆发式增长，全球 PCB 行业迈入蓬勃发展的新阶段。

在 AI 的强力驱动下，PCB 行业实现了快速增长。根据 Prismark 的数据，2025 年，全球 PCB 产值达 858.36 亿美元，同比增长 16.7%，为 2021 年之后行业再度实现两位数增速。中长期来看，全球 PCB 行业将进入新一轮景气上行周期，Prismark 预计 2030 年全球 PCB 产值将达到 1,446.10 亿美元，2025 年至 2030 年的年复合增长率将达到 11.0%，呈稳定增长趋势。2023 年至 2030 年全球 PCB 产值情况如下图所示：

图 2023-2030 年全球印制电路板产值



数据来源：Prismark 报告

2）全球 PCB 产业转移深化，中国大陆持续占据主导地位

PCB 产业在全球范围内广泛分布，其中美国、欧洲、日本等发达国家或地区因产业起步较早，曾长期占据行业主导地位。进入 21 世纪以来，亚洲，特别是中国大陆，凭借劳动力成本、原材料配套、行业政策及产业集群优势，吸引了全球电子制造业转移。伴随这一产业迁移进程的持续深化，全球 PCB 行业已形成

以亚洲，特别是中国大陆为核心制造枢纽的全新产业格局。全球主要 PCB 生产区域 2024 年及 2025 年产值、2025 年至 2030 年产值的年复合增长率情况如下：

单位：亿美元

国家/地区	2024 年		2025 年		2025 年产值增速	2025-2030 CAGR
	产值	占比	产值	占比		
美洲	35.33	4.80%	37.96	4.42%	7.5%	6.0%
欧洲	16.38	2.23%	17.74	2.07%	8.3%	7.1%
日本	58.40	7.94%	64.99	7.57%	11.3%	10.1%
中国大陆	410.73	55.83%	496.52	57.85%	20.9%	10.5%
亚洲其他地区	214.82	29.20%	241.14	28.09%	12.3%	13.2%
合计	**735.65**	**100.00%**	**858.36**	**100.00%**	**16.7%**	**11.0%**

数据来源：Prismark 报告

如上表所示，全球各主要 PCB 生产区域产值全面增长。2025 年中国大陆 PCB 产值同比增长 20.9%，占全球总产值的比重达 57.85%，增速与市场份额均领跑全球。中国台湾、韩国、泰国、越南等亚洲其他地区则受益于 AI 相关的需求以及产能扩张，2025 年 PCB 产值同比增长 12.3%，增长潜力持续释放。

3）PCB 下游应用领域广泛，AI 算力需求扩容为行业带来增量机遇

PCB 市场下游应用领域广泛，主要包括服务器/数据存储、手机、通信设备、计算机、汽车电子及其他消费电子等领域。下游电子系统市场的持续扩容，为 PCB 行业奠定坚实的增长基础。根据 Prismark 的数据，2025 年全球电子系统市场规模上调至 2.80 万亿美元，同比增长 9.8%。其中服务器/数据存储市场超预期增长 41.9%至 4,130 亿美元。展望 2026 年，全球电子系统市场有望突破 3.09 万亿美元，服务器/数据存储依旧为核心增长引擎，预计同比增速达 42.1%，增速保持强劲，持续拉动上游 PCB 需求扩容。具体而言，2025 年服务器/数据存储领域 PCB 产值以 46.9%的同比增速领跑，达到 160.31 亿美元，成为 PCB 行业规模最大、增速最快的下游应用领域；通信设备领域中，2025 年有线通信设备领域 PCB 产值同比增长 45.7%，无线通信设备领域 PCB 产值同比增长 15.9%。

（2）电子装联行业发展情况

电子装联处于 EMS 行业，指为各类电子产品提供制造服务的产业。目前全球 EMS 行业的市场集中度相对较高，国际上领先的 EMS 厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外的服务能力。电子装联行业供应链较为复杂，涉及包括 PCB、芯片、主动/被动元件等在内的各种电子元器件，供应链更容易受到上游零件短缺的冲击，因此供应链能力已成为电子装联行业的核心竞争力之一。此外，EMS 行业随着人工智能、大数据等新技术应用场景的多元化和应用深化，客户需求更加多样化、个性化，且新技术新产品迭代和更新频率加快，对于 EMS 厂商的柔性制造能力、服务响应速度、辅助设计与后端检测服务能力也提出了更高要求。

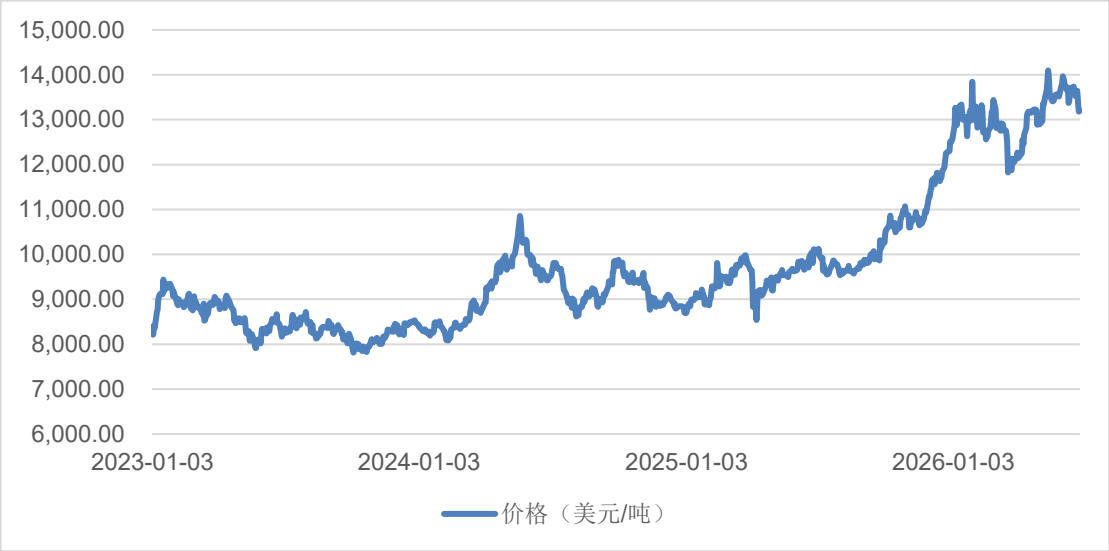
2、上下游行业发展状况

（1）上游发展情况

PCB 生产所需的原材料种类较多，主要为覆铜板、半固化片、金盐、油墨、铜箔、铜球、干膜等材料。覆铜板是生产 PCB 的核心基材之一，由玻纤布等增强材料浸以树脂，并单面或双面覆以铜箔经热压而成，主要承担印制电路板的导电、绝缘和支撑三大功能，其品质和性能与 PCB 的信号传输功能、可靠性关系密切，对 PCB 的制造有重要的影响。

除覆铜板外，铜箔和铜球亦是 PCB 生产的重要原材料。上述原材料的价格主要取决于国际铜价的变化，受大宗商品市场影响较大。2023 年 1 月至 2026 年 6 月，LME 国际铜价总体呈上升趋势，具体走势如下图所示：

图 2023 年 1 月至 2026 年 6 月 LME 国际铜价变化情况



数据来源：Wind

（2）下游主要应用领域发展情况

PCB 市场下游应用分布广泛，主要涉及服务器/数据存储、手机、通信设备、计算机、汽车电子及其他消费电子等领域；按该等下游应用领域划分，PCB 产值在 2024 年与 2025 年的分布以及 2025 年至 2030 年的年复合增长率情况如下：

单位：亿美元

项目	2024 年		2025 年		2025 年产值增速	2025-2030 CAGR
	产值	占比	产值	占比		
个人计算机	94.29	12.82%	101.96	11.88%	8.1%	2.9%
服务器/数据存储	109.16	14.84%	160.31	18.68%	46.9%	24.8%
其他计算机	36.49	4.96%	37.77	4.40%	3.5%	1.7%
手机	140.14	19.05%	150.46	17.53%	7.4%	4.5%
通信设备	93.30	12.68%	126.45	14.73%	35.5%	16.3%
消费电子	88.91	12.09%	94.75	11.04%	6.6%	3.7%
汽车电子	91.48	12.44%	97.17	11.32%	6.2%	3.4%
工业	29.18	3.97%	31.58	3.68%	8.2%	5.0%
医疗	15.00	2.04%	16.39	1.91%	9.3%	4.6%
其他	37.70	5.12%	41.53	4.84%	10.2%	6.3%
合计	**735.65**	**100.00%**	**858.36**	**100.00%**	**16.7%**	**11.0%**

数据来源：Prismark 报告

随着 AI 推动服务器、数据存储及高速网络设备等算力基础设施爆发式增长，服务器/数据存储、通信设备两大应用领域的 PCB 产值实现快速提升。根据 Prismark 的数据，2025 年至 2030 年，上述两大领域 PCB 产值增速最快，年复合增长率分别为 24.8%、16.3%。

1）服务器/数据存储领域

服务器是在网络环境中为客户端提供计算、存储、应用等服务的计算机，作为网络节点承担数据的存储与处理工作，广泛应用于云计算、互联网服务、人工智能等场景。相较于普通计算机，服务器在运算速度、负载能力、可靠性、I/O 数据吞吐能力及可扩展性等方面均有更高要求。其中，AI 服务器是面向人工智能训练、推理等应用场景的高性能计算设备，需适配高算力、高速互联、高功耗的运行环境，对硬件配套提出了更高的技术要求。服务器用 PCB 主要包括主板、加速板、电源背板、硬盘背板、网卡等。随着服务器性能持续提升，相关 PCB 产品正向高层数、高厚径比、高布线密度、高传输速率的方向演进，其中 AI 服务器用 PCB 的技术要求尤为突出。

①AI 服务器硬件架构迭代，显著抬升单台 PCB 价值量

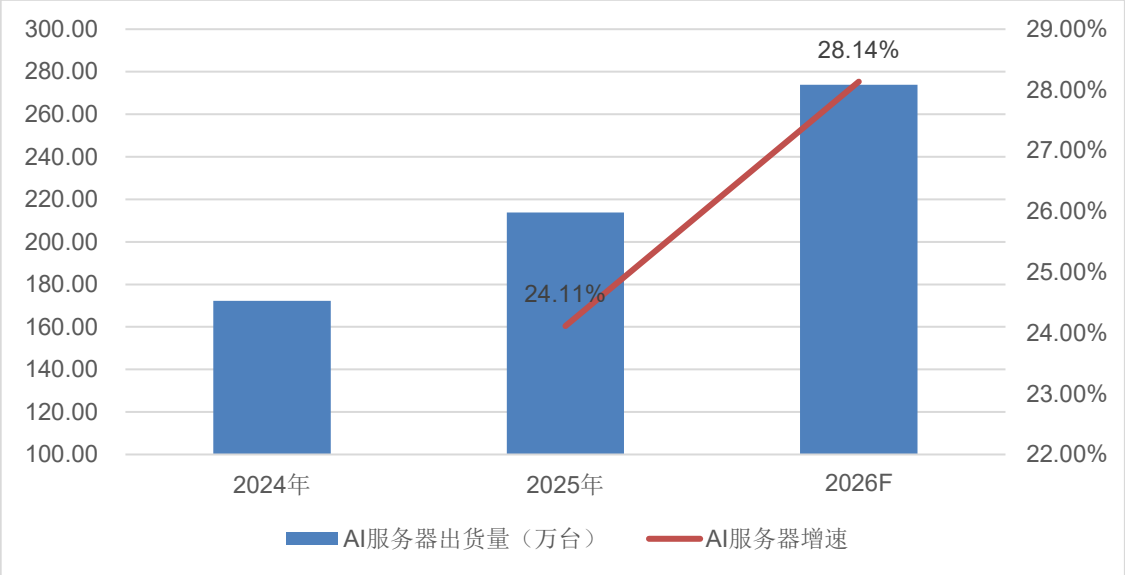
相较于传统 CPU 服务器，AI 服务器为适配多 GPU 高带宽互联的算力需求，硬件架构迭代升级，新增了 UBB（GPU 加速模组通用基板）、OAM（加速模块）等专用印制电路板，拓展了高速高密高多层 PCB 的应用场景与市场需求。其中，承载多 GPU 互连的 UBB 普遍采用 20–30 层高多层通孔板设计，并需配合背钻、树脂塞孔等工艺保证信号完整性，对稳定性与扩展性要求较高；同时，随着 AI 芯片集成度提升，OAM 等加速模组板正由传统通孔工艺向高阶 HDI 工艺演进。层数提升、工艺升级及新增专用板卡品类，共同推动 AI 服务器单台 PCB 价值量较传统服务器大幅增长。

②AI 服务器出货量高增，拉动 PCB 市场扩容

近年来，为满足市场对 AI 算力的强劲需求，全球主要云厂商及大模型厂商不断加大 AI 数据中心建设投入，带动 AI 服务器等核心算力设备的市场需求快速扩容。根据 TrendForce 数据，2025 年 AI 服务器出货量为 213 万台，同比增长 24.11%，预计 2026 年 AI 服务器保持快速增长态势，出货量将超过 270 万台，

同比增长 28.14%，具体情况如下图所示：

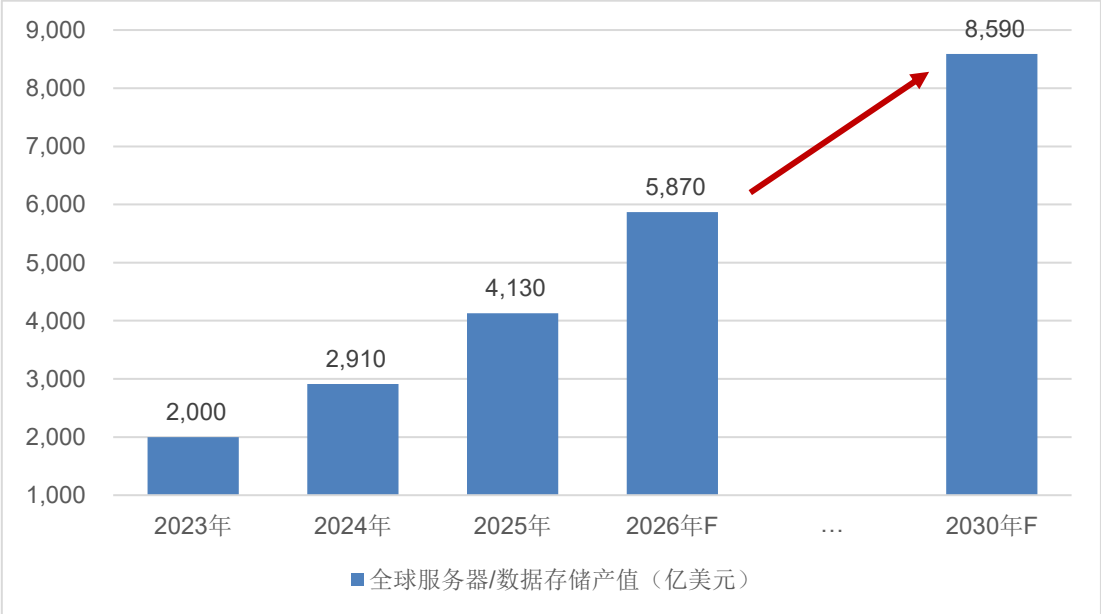
图 2024-2026 年全球 AI 服务器出货量及增速情况



数据来源：TrendForce

AI 服务器出货量的持续高增，直接拉动了服务器/数据存储产值规模的整体扩容。根据 Prismark 的数据，2025 年服务器/数据存储产值规模约为 4,130 亿美元，同比增长 41.9%。受益于人工智能带来的巨大计算和存储需求，Prismark 预计服务器/数据存储产值规模在 2025 年至 2030 年的年复合增长率将高达 15.8%。

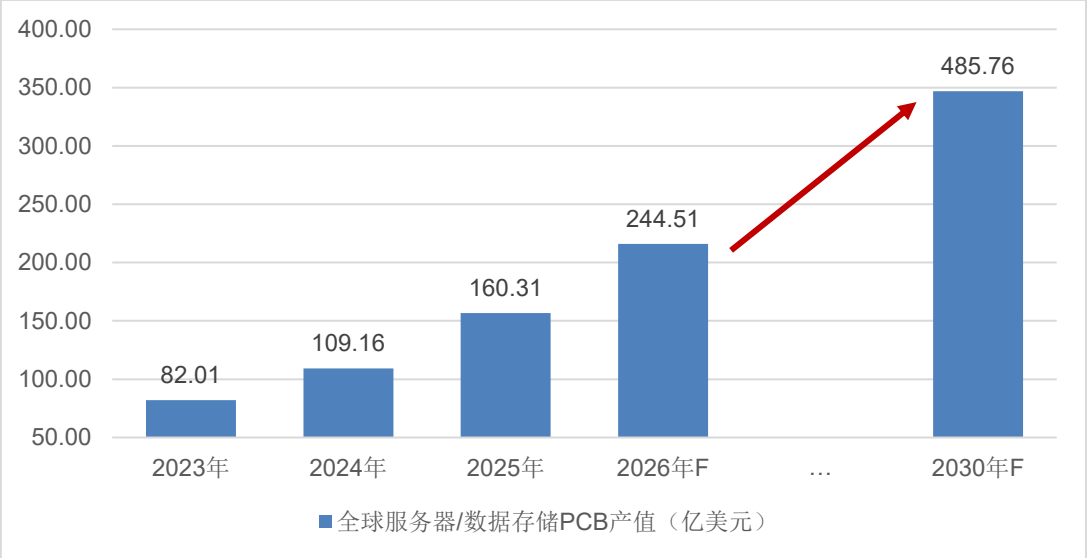
图 2023-2030 年全球服务器/数据存储产值情况



数据来源：Prismark 报告

作为服务器硬件系统的核心配套之一，服务器/数据存储领域的 PCB 市场随之迎来高速增长。根据 Prismark 的数据，2025 年全球服务器/数据存储领域 PCB 产值规模为 160.31 亿美元，同比增长 46.9%，增速显著高于其他应用领域；预计 2030 年全球服务器/数据存储领域 PCB 产值规模将达到 485.76 亿美元，2025 年至 2030 年将以 24.8%的年复合增长率领跑其他应用领域 PCB。

图 2023-2030 年全球服务器/数据存储领域 PCB 产值情况



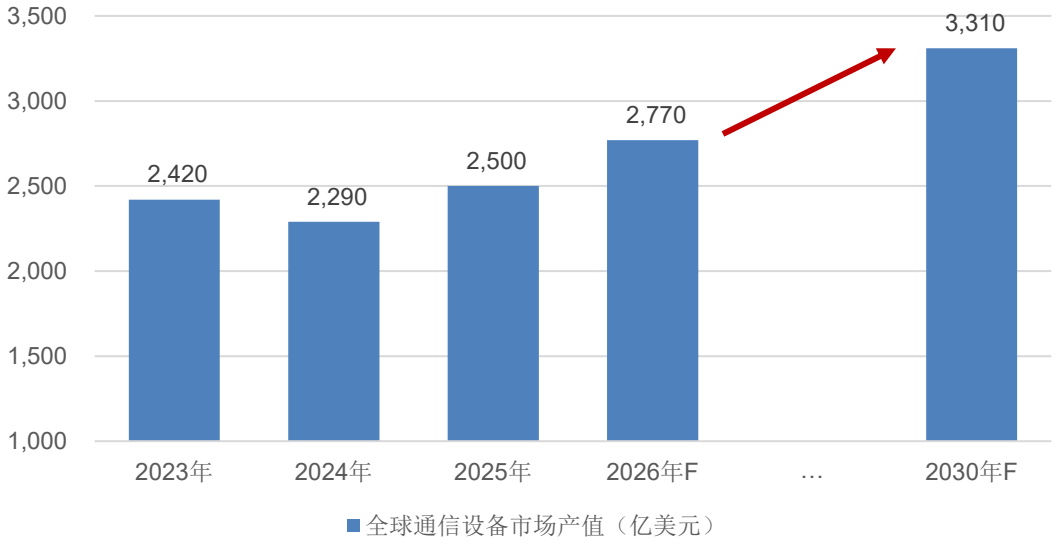
数据来源：Prismark 报告

2）通信设备领域

通信设备是用于信息传输交换的通信系统设备，按传输方式可分为有线通信设备和无线通信设备。其中，有线通信设备主要包括交换机、路由器、光传输设备等，广泛应用于数据中心互联等场景，承担数据的传输与交换功能；无线通信设备以通信基站为核心，为移动终端提供无线接入服务，实现网络信号覆盖。随着 AI 算力基础设施加速建设，交换机、路由器等网络设备不断向更高速率演进，带动高频高速板、高多层板等 PCB 产品需求快速增长。

根据 Prismark 的数据，2025 年全球通信设备领域（包括有线通信设备、无线通信设备）市场规模约 2,500 亿美元，同比增长 9.17%，预计 2026 年同比增长 10.80%，到 2030 年市场规模将达到 3,310 亿美元，2025 年至 2030 年的年复合增长率为 5.77%。

图 2023-2030 年全球通信设备领域市场产值情况

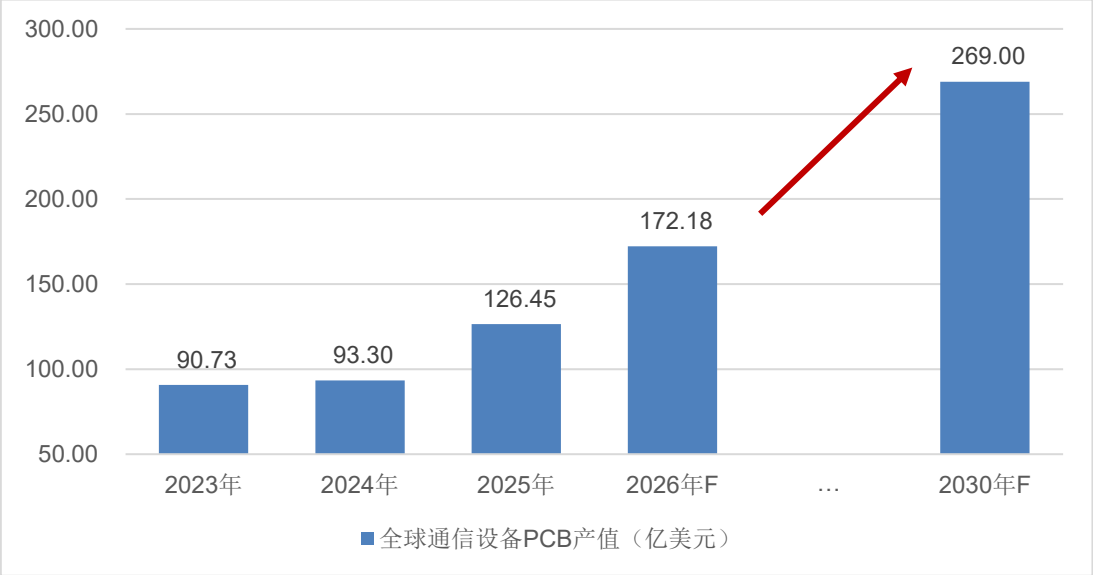


数据来源：Prismark 报告

通信设备市场的稳步扩张，为上游 PCB 市场提供了持续增长的需求基础。在有线通信网络中，交换机是承担数据交换的核心网络设备，光模块是实现光电信号相互转换的核心光器件，二者均为数据中心实现高速互联的关键硬件。随着大型科技厂商和云服务提供商积极推进 AI 数据中心扩建，低时延、高带宽网络基础设施部署提速，带动高速交换机和高速光模块需求增长。PCB 是交换机和光模块中实现高速信号传输的关键部件，其性能直接影响系统的整体功耗与互联效率；通信速率的持续提升，推动通信 PCB 的规格与工艺要求不断升级。此外，高速交换机与高速光模块市场渗透率提升，将进一步带动高多层、高速 PCB 产品需求增长。

根据 Prismark 的数据，2025 年全球通信设备领域 PCB 产值为 126.45 亿美元，同比增长 35.53%；预计 2026 年产值将达 172.18 亿美元，同比增长 36.16%；预计到 2030 年，全球通信设备领域 PCB 产值将达到 269.00 亿美元，2025 年至 2030 年将保持 16.30%的年复合增长率。

图 2023-2030 年全球通信领域 PCB 产值规模情况



数据来源：Prismark 报告

3、行业发展趋势

随着人工智能等新兴产业的加速演进，电子系统的复杂度显著提升，对 PCB 产品的布线密度、信号传输性能和可靠性提出了更高要求，驱动 PCB 产品向高密度、高性能方向持续升级。与此同时，高端 PCB 产品的技术与资金壁垒不断提高，具备技术储备和资本实力的头部企业竞争优势日益凸显，市场份额加速向头部企业集中，行业集中度稳步提升，PCB 产业整体呈现高附加值化的发展趋势。

（1）产品向高密度化、高性能化方向发展

PCB 作为电子元器件的核心支撑与互联平台，其技术演进随下游应用呈现不同的路径：在服务器/数据存储、通信设备与汽车电子领域，为满足更高算力、更高速率及更高可靠性的要求，PCB 向大尺寸、高层数、高密度及高速材料应用升级；在移动终端、消费电子领域，受设备持续轻薄化、功能高度集成及主芯片引脚密度攀升的驱动，PCB 需在有限空间内实现更高密度的元器件布局与信号互连，推动 HDI、类载板向更高互连密度演进。不同应用领域虽终端形态与需求场景不同，但均以“高密度化”与“高性能化”为核心方向，共同响应下游电子设备对布线密度、信号完整性与高可靠性的升级需求。

（2）行业集中度持续提升

随着下游应用领域技术要求不断提高、终端产品更新换代加速，PCB 行业的技术与资金壁垒持续抬升。技术实力储备深厚、品牌声誉良好、具备规模化运营能力的大型厂商更具竞争优势，而中小厂商受限于研发与资本投入难以跟进，行业市场份额加速向头部企业集中。根据 Prismark 的数据，全球前五大 PCB 厂商的市场份额从 2006 年的 10.80%增长至 2025 年的 23.15%，行业集中度持续提升。

（3）新兴产业推动行业向高附加值方向升级

PCB 产品作为电子元器件电气连接与机械支撑的基础平台，是电子信息产业不可或缺的关键组成部分。当前，人工智能、高性能计算、6G 通信、低空经济等战略新兴产业和未来产业加速演进，推动电子系统复杂度显著提升，对 PCB 产品在精度、密度、信号完整性等方面提出更高要求。上述新兴产业的发展推动 PCB 企业持续加大研发投入、提升生产工艺和技术水平，促进行业整体向高附加值方向升级。

4、行业经营模式及行业特征

（1）行业经营模式

在生产方面，由于 PCB 产品具有较强的定制性特点，不同客户对产品的要求各不相同，PCB 生产需根据客户产品的技术特点和设计要求进行量身定制。因此，PCB 行业主要采用订单生产模式，部分实力较强的 PCB 企业能够通过参与客户产品方案前端设计的方式主动获得客户订单，从而提高产品的附加值。

在采购方面，PCB 企业通常选择多个供应商进行资质鉴定或对比，从而确定长期合作伙伴。针对个别具有个性化需求的客户，部分 PCB 生产厂商也会接受客户指定的材料。

在销售方面，为快速响应客户需求，加强与客户的技术交流合作，PCB 企业一般以直销为主，直接向客户销售产品。对于出口产品，部分企业也会通过代理商进行销售。

（2）行业的周期性、季节性和区域性特征

1）周期性

PCB 行业的周期性受宏观经济波动的影响。PCB 行业下游应用领域越来越广泛，涉及服务器/数据存储、手机、通信设备、计算机、汽车电子及其他消费电子等。下游市场需求受宏观经济周期性波动影响，进而影响 PCB 行业的需求与发展。PCB 行业受单一下游行业波动影响较小，宏观经济波动及电子信息产业整体发展状况对本行业的影响较大。

2）季节性

PCB 行业的季节性受 PCB 产品所定位的下游市场特点影响。对于下游面向个人消费者需求的 PCB 厂商，其生产和销售受季节影响较大；对于下游面向企业级用户需求的 PCB 厂商，其生产和销售受季节影响较小，季节性特征不明显。

3）区域性

全球 PCB 产值主要集中在中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美洲和欧洲等地区，中国大陆是全球 PCB 最大的生产基地。近年来，在下游产业向东南亚转移的带动下，东南亚投资布局成为 PCB 行业的新发展趋势。

国内 PCB 厂商主要集中在珠三角、长三角等电子信息产业基础较好的地区。近年来，随着沿海地区劳动力成本的上升，以及产业链协同优化和区域产业政策支持，部分 PCB 企业逐步将新增产能布局至中西部地区。同时，随着全球电子制造产业链向东南亚地区延伸及国际客户供应链多元化需求不断增强，部分国内 PCB 企业亦积极在泰国、越南、马来西亚等地布局生产基地，以提升全球化配套和交付能力。

四、发行人所处行业竞争情况

（一）行业整体竞争格局

1、印制电路板行业

全球 PCB 生产企业众多，市场竞争较为充分。根据 Prismark 的数据，全球有超过 2,100 家 PCB 生产企业，主要分布在中国大陆、中国台湾、日本、韩国和欧美等地区。在 Prismark 发布的 2025 年全球百强 PCB 企业中，91 家企业总

部位于亚洲，亚洲地区在全球 PCB 产业中占据主导地位，其中总部位于中国大陆的企业有 43 家。中国大陆 PCB 产值增速较快，且中国大陆目前是全球最大的 PCB 生产基地，产值占比超过 50%。

根据 Prismark 统计，2025 年全球前十大印制电路板厂商排名如下：

单位：亿美元

排名	企业名称	股票代码	总部	2025 年营业收入		市场占有率
				金额	增长率	
1	臻鼎科技控股股份有限公司	4958.TW	中国台湾	58.69	9.9%	6.84%
2	欣兴电子股份有限公司	3037.TW	中国台湾	42.25	17.5%	4.92%
3	苏州东山精密制造股份有限公司	002384.SZ	中国大陆	35.70	3.4%	4.16%
4	**深南电路股份有限公司**	**002916.SZ**	**中国大陆**	**32.95**	**32.2%**	3.84%
5	TTM Technologies, Inc.	TTMI	美国	29.06	19.0%	3.39%
6	WUS GROUP	-	中国台湾	27.60	40.8%	3.22%
7	胜宏科技（惠州）股份有限公司	300476.SZ	中国大陆	26.86	79.9%	3.13%
8	华通电脑股份有限公司	2313.TW	中国台湾	24.46	8.4%	2.85%
9	健鼎科技股份有限公司	3044.TW	中国台湾	23.61	15.2%	2.75%
10	Mektec Corporation	-	日本	22.73	-9.2%	2.65%
合计				**323.91**	**-**	**37.74%**

数据来源：Prismark 报告

注 1：市场占有率=2025 年度营业收入÷2025 年度全球印制电路板行业产值

注 2：WUS GROUP 主要为沪士电子股份有限公司（股票代码：002463.SZ）

深南电路 2025 年营业收入位列全球第 4 名，其产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等市场。

从产业布局来看，我国已成为全球 PCB 产业最重要的生产基地之一，拥有完善的产业链配套体系。经过多年发展，绝大部分世界知名 PCB 生产企业均已在中国大陆设立生产基地。目前，我国 PCB 企业主要分布在珠三角、长三角等电子行业集中度高、基础元件需求旺盛且交通运输条件优越的区域。近年来，随着土地、人工等生产要素成本上升，以及客户全球化布局、供应链风险分散等因素驱动，部分 PCB 企业逐步将新增产能向中西部地区转移，并积极在泰国、越南、马来西亚等东南亚国家建设生产基地。综上，我国 PCB 行业已形成中国台资、外资及本土企业共同发展的市场竞争格局，市场竞争较为充分。

根据 CPCA 发布的中国电子电路行业排行榜，2025 年中国 PCB 制造前十大企业情况如下：

单位：亿元

排名	企业名称	股票代码	2025 年营业收入		备注
			金额	增长率	
1	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	002938.SZ	391.47	11.40%	-
2	苏州东山精密制造股份有限公司	002384.SZ	256.20	3.30%	PCB 部分
3	深南电路股份有限公司	002916.SZ	236.47	32.05%	-
4	胜宏科技（惠州）股份有限公司	300476.SZ	192.92	79.77%	-
5	沪士电子股份有限公司	002463.SZ	189.45	42.00%	-
6	健鼎科技股份有限公司	3044.TW	153.52	18.63%	-
7	深圳市景旺电子股份有限公司	603228.SH	153.08	20.92%	-
8	华通电脑股份有限公司	2313.TW	125.63	7.95%	仅中国大陆工厂
9	欣兴电子股份有限公司	3037.TW	124.06	22.76%	仅中国大陆工厂
10	建滔集团有限公司	00148.HK	122.00	10.51%	包含：依利安达、科惠、荣信、扬宣、东阳、建业、万年富
合计			1,944.80	-	-

数据来源：CPCA

根据 CPCA 公布的中国电子电路行业排行榜，深南电路 2025 年销售收入在国内 PCB 企业中位列第 3 名。

2、封装基板行业

全球封装基板行业集中度较高，主要由中国台湾、日本及韩国等地区的厂商主导。封装基板技术壁垒较高，行业格局整体相对稳固，其中，欣兴电子、南亚电路、三星电机及揖斐电等厂商的市场地位较为突出。国内封装基板产业起步相对较晚，实现产业化布局的企业主要有深南电路、兴森科技、越亚半导体等。目前国内企业以中低端封装基板产品为主，高端产品领域仍存在技术差距，国产替代空间较大。与此同时，部分印制电路板企业亦开始布局封装基板业务。

①深南电路

深南电路自 2008 年率先布局封装基板领域，经过多年的深耕和积累，已发展成为内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。2026 年 1-6 月，公司封装基板业务实现收入 366,671.91 万元，同比增长 110.76%。

②兴森科技

兴森科技自 2012 年开始从事集成电路封装基板业务，主攻存储方向。2026 年 1-6 月，兴森科技 IC 封装基板业务（含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板）实现收入 120,896.51 万元，同比增长 67.34%，其中，CSP 封装基板业务聚焦于存储、射频两大主力方向。

③越亚半导体

珠海越亚半导体股份有限公司（以下简称“越亚半导体”）成立于 2006 年，2025 年，越亚半导体 IC 封装载板业务实现收入 138,430.13 万元，产品涵盖射频模组封装载板、ASIC 芯片封装载板、倒装芯片球栅阵列封装载板和电源管理芯片封装载板等。

（二）公司在行业内的竞争地位

经过四十余年的深耕与发展，深南电路拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务。公司已成为中国电子电路行业领先企业、中国封装基板领域先行者、电子装联特色企业，系国家高新技术企业、中国电子电路行业协会理事长单位。目前，公司在算力领域具备全球竞争力，是全球领先的通信设备 PCB 供应商、内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造特色企业。根据 Prismark 的数据，2025 年公司营收规模在全球印制电路板厂商中位列第 4。总体来看，公司的综合实力和行业地位居行业前列。

（三）主要竞争对手

PCB 生产企业众多，各公司在技术层级、产能规模、应用领域上存在一定差别，在各自细分市场均具有一定竞争优势。公司在行业内主要竞争的 A 股上市公司概况如下：

单位：亿元

上市公司简称	注册地	上市日期	主营业务情况	2026 年 1-6 月	
				营业收入	归母净利润
鹏鼎控股	广东省深圳市	2018-9-18	公司是主要从事各类印制电路板的研发、设计、制造、销售与服务为一体的专业大型厂商，专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求，为客户提供涵盖 PCB	172.17	12.84

上市公司简称	注册地	上市日期	主营业务情况	2026 年 1-6 月	
				营业收入	归母净利润
			产品研发、设计、制造与销售服务各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司 PCB 产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板、汽车\服务器及其他用板等，产品广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器、汽车电子等下游领域。		
胜宏科技	广东省惠州市	2015-6-11	公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售。公司主要产品覆盖刚性电路板（多层板和 HDI 为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）全系列，广泛应用于人工智能、汽车电子（新能源）、新一代通信技术、大数据中心、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域。	116.29	28.57
沪电股份	江苏省昆山市	2010-8-18	公司主要业务属于电子元器件行业中的 PCB 制造业，公司产品以数据通讯、智能汽车为核心应用领域，辅以工业控制及其他应用领域，主要用于 AI 服务器及 HPC、高速网络交换机及路由器、通用服务器、汽车智能及电动化系统、汽车安全系统及工业设备。	136.89	29.23
景旺电子	广东省深圳市	2017-1-6	公司是专业从事 PCB 研发、生产和销售的国家高新技术企业，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一。经过三十余年的发展，公司形成了齐全的产品矩阵，覆盖多层板、HDI、高多层板、FPC、MPCB 及刚挠结合板等。	86.11	6.02
生益电子	广东省东莞市	2021-2-25	公司自 1985 年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品按照应用领域划分主要包括计算机/服务器板、通信网络设备板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。	57.84	11.11
兴森科技	广东省深圳市	2010-6-18	公司主营业务聚焦于“先进电子电路”和“数字化制造”两大战略方向，经过 32 年的持续深耕与发展，公司涵盖传统高多层 PCB 板、软硬结合板、高密度互连 HDI 板、类载板（SLP）、ATE 半导体测试板、封装基板（含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板）等全类别产品，可为客户提供研发--设计--制造--SMT 贴装的一站式服务。	40.38	1.11
广合科技	广东省广州市	2024-4-2	公司主营业务为多高层印制电路板的研发、生产与销售，产品广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域，其中服务器用 PCB 产品的收入占比约八成，是公司产品最主要的下游应用	43.88	9.56

上市公司简称	注册地	上市日期	主营业务情况	2026 年 1-6 月	
				营业收入	归母净利润
			领域，产品应用于高性能计算服务器、AI 运算服务器、存储服务器、交换机等数据中心的核心设备，为全球大数据、云计算等产业提供重要电子元器件供应。		
方正科技	上海市	1990-12-19	公司的主营业务为印制电路板（PCB）的研发设计、生产制造及销售，核心产品覆盖高多层板、HDI 板、软硬结合板及个性化定制 PCB 等品类。产品深度应用于通讯设备、智能终端、交换机、光模块、AI 服务器、特殊应用等新兴产业领域。	37.00	5.74

注：信息来源于各上市公司定期报告

（四）公司竞争优势

1、独特的“3-In-One”商业模式，高效协同的完整产业布局

公司专注于电子互联领域，深耕电子电路行业，经过四十余年的发展，已形成“技术同根、客户同源”的“3-In-One”业务布局。公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。印制电路板、封装基板和电子装联三项业务持续突破，高效协同，核心竞争力不断强化。

2、领先的技术研发实力，先进的工艺技术水平

公司始终坚持技术领先战略，以技术发展为第一驱动力，保持高研发投入，不断提升自主研发和创新能力。公司通过设置三级研发体系，在总部、事业部和生产工厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部，形成有效配合，不断推动公司技术能力的提升，奠定了公司从工艺技术到前沿产品开发的行业领先优势。经过多年的研发和创新，公司已开发出一系列拥有自主知识产权的专利技术。以背板为例，当前公司背板样品最高层数可达 120 层，批量生产层数可达 68 层，处于行业领先地位。

2025 年，公司研发主要面向下一代通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术，FC-BGA 基板产品能力建设，FC-CSP 精细线路基板和射频基板技术能力提升，侧重高速大容量、高多层、改良半加成法（mSAP）、高频微波、高密小型化和大功率热管理等重点技术方向。

3、深厚的行业积淀，扎实的客户基础

公司深耕电子电路行业四十余年，已成为众多全球领先企业的主力供应商，并在业内形成技术领先、质量稳定可靠的良好口碑，具有较高的品牌知名度。同时，公司始终坚持以客户需求为导向，积极配合客户项目研发及设计，快速响应，持续为客户创造价值，为公司长期稳定发展提供了充足动能。公司近年来屡获多个战略客户颁发的“金牌供应商”、“最佳供应商”、“最佳合作伙伴”、“最佳质量表现奖”、“联合创新奖”等相关奖项。

4、完善的管理体系，稳步提升的工厂运营效率

公司坚持推进管理创新，不断完善科学系统的管理体系。公司拥有健全有效的质量管理体系，经过多年的经营，积累了先进的工艺生产技术，制定了各类业务标准操作流程，为产品可靠性的提升提供有效保障。近年来，公司积极推进研发、市场等关键业务流程变革，建设流程型组织，保持组织活力。公司持续推进专业化、自动化、数字化工厂建设，不断提升工厂运营效率。报告期内，南通深南、无锡深南获评 2025 年江苏省先进级智能工厂等称号。

5、高效、专业的团队，完善的人才培养和团队建设机制

公司高度重视人才的选育用留，培育出了一支开拓创新、团结进取的研发技术与专业管理队伍。公司管理团队主要成员深耕行业多年，具备专业的行业领域知识与经验、良好的职业素养，对所在行业有着深刻认知，具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。公司多次获得政府部门授予的技术奖励，同时已获批建立博士后创新实践基地，并与国内多家知名院校建立了长期稳定的校企合作关系，为公司持续稳定地获得大量高素质人才提供保障。此外，公司还基于战略需求不断完善员工培育体系，加强人才梯队建设，强化员工技能，助力员工与企业共同成长。

6、先进的清洁环保生产能力

公司一直高度重视环境保护工作，1999 年通过 ISO14000 环境管理体系认证，2008 年成立清洁生产委员会（后调整为绿色生产管理委员会），多年来贯彻科学发展、预防为主的管理思路，实施节能减排降耗、推行清洁生产，并依据国家及地方的环保法律法规，制定了《环境保护责任制度》等环保管理制度。公

司绿色生产管理委员会设置绿色采购、源头管理、资源回用、污染减排等多个专项推进小组，将绿色发展理念系统地融入到产品设计、生产运营、供应链管理等各个方面，根据“减量化、资源化、无害化”的管理思路，系统性持续推进降低能源资源消耗和废弃物处理工作。公司在生产工艺与设备、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用、环境管理五个维度下的各项指标和要求均达到行业清洁生产一级标准，碳排放强度指标优于政府指定的目标，清洁生产能力在行业内保持领先地位。

五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）发行人主营业务及产品情况

深南电路自成立以来始终专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”。公司以互联为核心，不断强化印制电路板业务行业领先地位的同时，逐步拓展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务（含电子整机/系统总装），形成了业界独特的印制电路板、封装基板、电子装联“3-In-One”的业务布局，覆盖 1 级到 3 级封装产业链环节。

发行人主要产品简要情况如下：

1、印制电路板

印制电路板是指在覆铜板上按照预定设计形成铜线路图形的电路板，是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能，是绝大多数电子设备及产品不可或缺的组件，因而被称为“电子产品之母”。公司专业从事中高端印制电路板的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。公司 PCB 产品重点应用领域如下：

应用领域		主要设备	相关 PCB 产品	特征描述
通信	无线网	通信基站	背板、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板	金属基、大尺寸、高多层、高频材料及混压
	传输网	OTN 传输设备、微波传输设备	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压

应用领域		主要设备	相关 PCB 产品	特征描述
	核心网	路由器、交换机、光模块	背板、高速多层板、高频微波板、HDI	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压、多阶 HDI、细密线路
	固网宽带	OLT、ONU 等光纤到户设备	背板、高速多层板	多层板、刚挠结合
数据中心		服务器/存储设备、电源	背板、高速多层板、HDI	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、多阶 HDI、细密线路
汽车电子		毫米波雷达、激光雷达、摄像头、新能源汽车三电系统	高频微波板、刚挠结合板、厚铜板	高频材料及混压、高可靠性、HDI、刚挠结合、多层板、厚铜
工控医疗		工控、医疗系统	高速多层板	高可靠性、多层板、刚挠结合
消费电子		电池保护、光学摄像、无线耳机等	刚挠结合板、HDI	高密度、轻薄、立体组装、高可靠性

2、封装基板

封装基板与 PCB 制造原理相近，是 PCB 适应电子封装技术快速发展而向高端技术的延伸，两者存在着一定的相关性。封装基板作为一种高端的 PCB，具有高密度、高精度、高性能、小型化及薄型化等特点，是芯片封装不可或缺的一部分，不仅能够为芯片提供支撑、散热和保护作用，也为芯片与 PCB 母板之间提供电气连接。

公司生产的封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司目前已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的封装基板技术能力，覆盖了包括半导体垂直整合制造商、半导体设计商以及封测厂商等主要客户群，并与多家全球领先厂商建立了长期稳定的合作关系，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。其中，针对 FC-BGA 封装基板产品，公司通过近年来持续的技术研发工作，已实现部分产品的技术能力突破，相关客户认证及产能建设工作取得进展。

3、电子装联

电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，系指依据设计方案将无源器

件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在PCB上，实现电子电气的互联，并通过功能及可靠性测试，形成模块、整机或系统。公司电子装联产品按照产品形态可分为PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，主要应用于通信、数据中心、医疗电子、汽车电子等领域。目前公司已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技术支持等全方位服务的能力。凭借专业的设计能力、扎实的技术实力、不断夯实的智能制造能力、稳定可靠的质量口碑以及快速的客户响应，公司电子装联业务已与多家全球领先企业建立起长期战略合作关系。公司坚持深耕大客户策略，电子装联业务多年来始终保持稳定发展。

（二）发行人主要经营模式

1、采购模式

公司已制定《采购招标管理制度》等制度，严格控制公司对供应商的筛选程序及原材料的采购行为。对于通用原材料，公司按照安全库存及预计耗用量采购；对于非通用物料，公司按照实际订单需求采购。

2、生产模式

由于公司主要产品均为定制化产品，主要实行以销定产的生产模式，根据订单来组织和安排生产，有助于公司控制成本和提高资金运用效率。公司各个事业部均设有生产计划部门，对生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调生产、采购和仓库等各相关部门，保障生产的有序进行。公司已建立完善的生产流程，能够快速、有效处理客户订单，保证按时生产、发货。

3、销售模式

公司采用直销的销售模式，直接与客户签订买断式购销合同或确认订单；客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求、销售价格、数量、支付条款、交货时间、送货方式等。

对于印制电路板、封装基板产品，根据行业惯例，公司通常与客户先签署无固定期限合作框架性协议，客户会定期或不定期地按需向公司发出具体采购订单，包含技术要求、销售价格、数量、支付条款、交货时间、送货方式等；公司与客户确认采购需求后开始组织安排生产，按照客户订单要求交付生产完工的产品，

及时进行货款结算。

针对电子装联产品，公司采用 Turnkey 和 Consign 两种模式进行销售。Turnkey 模式下，根据客户订单需求，公司自行组织原材料采购，完成生产后交付产品，按照包含原材料的全成本确定销售价格并进行货款结算；Consign 模式下，客户提供绝大部分原材料，公司仅自主采购少数辅料，在完成生产并交付产品后，仅向客户收取加工费用。

（三）主要经营资质

截至本募集说明书出具日，公司持有如下与从事主营业务有关的有效证照、许可文件：

1、高新技术企业证书

序号	公司名称	证书编号	有效期
1	深南电路	GR202344202897	2023.10.16-2026.10.16
2	无锡深南	GR202532002547	2025.11.18-2028.11.18
3	南通深南	GR202332011145	2023.12.13-2026.12.13
4	天芯互联	GR202544202062	2025.12.25-2028.12.25
5	广州广芯	GR202344014927	2023.12.28-2026.12.28
6	深圳广芯	GR202444206589	2024.12.26-2027.12.26
7	无锡广芯	GR202432011324	2024.12.16-2027.12.16

2、排污许可证

序号	主体	证书编号	行业类别	发证机关	有效期
1	深南电路	914403001921957616003V	电子电路制造，计算机整机制造，其他计算机制造	深圳市生态环境局龙岗管理局	2024.9.5-2029.9.4
2	深南电路（坪西基地）	914403001921957616004Z	电子电路制造，通信终端设备制造	深圳市生态环境局龙岗管理局	2026.8.5-2031.8.4
3	无锡深南	91320214053457776M001W	电子电路制造，锅炉	无锡市生态环境局	2025.12.2-2030.12.1
4	南通深南	913206123212589858001V	电子电路制造，锅炉	南通市生态环境局	2026.3.19-2031.3.18
5	天芯互联	91320214592592432C002V	集成电路制造	深圳市生态环境局	2024.11.21-2029.11.20
6	广州广芯	91440101MA9Y1DC01P001U	电子电路制造	广州开发区行政审批局	2025.7.28-2030.7.27

序号	主体	证书编号	行业类别	发证机关	有效期
7	深圳广芯	91440300MA5HKBMX04001V	电子电路制造	深圳市生态环境局龙岗管理局	2023.12.1-2028.11.30

3、固定污染源排污登记回执

序号	单位名称	登记编号	有效期
1	无锡广芯	91320214MAC508PL6H001Y	2023.7.11-2028.7.10
2	深南电路（长山园区）	91440300192195761600 7W	2026.6.22-2031.6.21
3	深南电路七彩人生园区	91440300192195761600 6Y	2025.9.29-2030.9.28
4	深南电路钻孔中心	91440300192195761600 5W	2025.5.29-2030.5.28
5	无锡深南鸿翔路 85 号厂区	91320214053457776M004X	2026.7.24-2031.7.23
6	无锡深南长江东路 8 号厂区	91320214053457776M003W	2026.6.30-2031.6.29
7	无锡深南永丰工业园厂区	91320214053457776M002W	2025.12.19-2030.12.18

4、进出口资质

序号	公司名称	海关备案编码	所在地海关	经营类别
1	深南电路	44031659G2	福中海关	进出口货物收发货人
2	无锡深南	3202312609	无锡海关	进出口货物收发货人
3	南通深南	320696219A	南通海关	进出口货物收发货人
4	天芯互联	4403961AHE	福中海关	进出口货物收发货人
5	广州广芯	4401960LZJ	穗东海关	进出口货物收发货人
6	深圳广芯	4403962G6Z	福中海关	进出口货物收发货人
7	无锡广芯	320231300A	无锡海关	进出口货物收发货人

（四）主要产品的产能利用及销售情况

报告期内，公司主要产品的产能、产量整体呈现增长趋势，与公司近年的扩产情况相匹配，产能利用及销售情况如下表所示：

产品类别	项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
印制电路板	产能利用率	98.80%	96.32%	87.59%	73.36%
	产销率	91.29%	96.89%	95.95%	98.61%
封装基板	产能利用率	93.00%	93.89%	87.67%	88.86%

	产销率	106.10%	87.28%	98.07%	99.58%
电子装联	产能利用率	92.36%	93.59%	91.85%	93.29%
	产销率	96.90%	101.44%	90.90%	97.09%

（五）原材料及能源采购情况

1、主要原材料的供应情况

报告期内，公司采购的主要原材料为覆铜板、半固化片、金盐、油墨、铜箔、铜球、干膜等，采购的产品类别及型号众多，主要原材料的供应商均系国内外知名企业，已与公司建立了长期、稳定的合作，原材料供应较为稳定。

2、主要能源的供应情况

报告期内，公司采购的主要能源为电力，供应稳定、充足，电力采购金额分别为 51,323.26 万元、60,091.37 万元、67,847.88 万元和 40,233.35 万元，占主营业务成本的比例相对较低。

（六）主要固定资产及无形资产情况

1、主要固定资产情况

公司固定资产主要系房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。截至 2026 年 6 月 30 日，公司固定资产总体情况如下：

单位：万元

固定资产类别	账面原值	账面净值	成新率	分布情况
房屋及建筑物	688,942.58	588,672.88	85.45%	深南电路、无锡深南、广州广芯、南通深南、泰兴电路等
机器设备	1,197,390.91	675,166.73	56.39%	深南电路、无锡深南、南通深南、广州广芯等
运输设备	16,098.04	6,152.88	38.22%	深南电路、无锡深南、南通深南等
电子设备	270,640.08	121,245.31	44.80%	深南电路、无锡深南、无锡广芯等
其他	213,405.47	116,963.38	54.81%	南通深南、广州广芯等
合计	2,386,477.08	1,508,201.18	63.20%	-

注：成新率＝账面净值/账面原值，未考虑减值准备影响

2、无形资产情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人无形资产账面价值合计 71,341.56 万元，

主要为土地使用权 63,007.54 万元，占无形资产账面价值的 88.32%。

（七）发行人核心技术来源及技术保护措施

公司高度重视核心技术的保护工作，一方面通过申请国家专利，充分保护公司的知识产权；另一方面，对于涉及核心工艺等高度机密的技术实行分级管理，有效防止技术泄密，同时公司与相关核心技术人员签署保密协议，通过法律手段保护公司的核心技术。

公司核心技术主要来源于自主研发，公司对核心技术均拥有所有权及使用权。公司已建立完善的知识产权管理体系和技术保密机制，可以有效保护公司的核心技术。公司核心技术权属清晰，不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷。

六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略

（一）公司发展战略

深南电路始终专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。公司以互联为核心，在不断强化印制电路板业务领先地位的同时，大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。公司业务覆盖 1 级到 3 级封装产业链环节，具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，能够为客户提供专业高效的“产品+服务”一站式综合解决方案。

未来，公司将继续聚焦“3-In-One”的电子互联战略。在印制电路板业务上，持续构建并迭代高速大容量、高频微波、散热大功率、细密小型化的解决方案，匹配算力、通信、汽车电子等下游市场需求，巩固细分领域优势地位，形成核心竞争力。

公司将依托自身电子互联技术平台，持续强化研发创新、品质管控、智能制造与交付保障能力，提升面向全球优质客户的综合解决方案能力，不断增强市场竞争力，实现高质量发展。

（二）业务发展安排

围绕“3-In-One”的业务布局与发展战略，公司具体业务发展安排如下：

1、紧抓市场机遇，巩固行业领先地位

在印制电路板业务方面，公司将巩固市场领先地位，持续为下游全球头部客户提供高质量产品与服务。公司将紧抓 AI 算力、汽车电子、存储等市场机遇，加快面向增量市场的产能建设，保持细分市场全球份额领先，以技术升级引领产品结构向高附加值、高壁垒方向优化，强化在多领域的领先供应商地位与质量口碑。

2、突破高端产品，提升核心供给能力

在封装基板业务方面，公司将始终把科技创新作为核心驱动力，持续提升产品技术，积极研发新型封装技术应用，并推动封装基板工厂稳定运营与盈利能力提升，以高端产品突破带动业务结构升级，提升公司在核心领域的供给能力。

3、聚焦高附加值，打造特色电子装联

电子装联业务正从传统加工制造向更高附加值、更综合的服务能力升级。公司聚焦核心市场，围绕重点客户持续打造特色电子装联，推动业务模式优化，实现大客户突破，并据此带动业务规模与盈利能力的双提升，以差异化、高附加值的电子装联能力构筑长期竞争壁垒。

4、智能制造与数字化转型

公司将持续落实数字化平台建设，不断提升智能化、数字化水平，着力打造全连接、全在线、共享智能的数字化体系，以智能工厂为抓手打造高效、柔性的智能制造体系，同时加快对数字孪生、AI 等前沿技术的应用探索，聚焦其在产品技术迭代与质量保障等方面的部署落地，驱动公司生产经营效率和精益管理水平全面提升。公司致力于以数字化、智能化能力夯实长期竞争力的底层支撑，更好契合全球客户对高质量、快响应制造服务的需求。

5、加强供应链保障

公司将着力构建持续、稳定的国际化供应链能力，以此支撑国际市场开发和项目获取，积极拓展关键原材料和高端材料的供应商资源，降低单一供应的依赖

风险，不断巩固产业链的安全性和稳定性。

6、持续推进组织与人才发展

公司将围绕战略目标推动组织变革与优化，加强国际化人才和高端技术专业人才的引进，以此支撑高端产品持续升级突破，同时构建与战略目标相匹配的人才管理机制和组织管理模式，激活人才活力，引领公司业务持续发展。

七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

（一）财务性投资的认定依据

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。”

根据中国证监会发布的《证券期货法律适用意见第 18 号》，对财务性投资的界定标准及相关规定如下：

1、财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等；

2、围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资；

3、上市公司及子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表；

4、基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径；

5、金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）；

6、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性

投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，类金融业务的界定为：除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。

（二）截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在持有金额较大的交易性金融资产和其他权益工具投资、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。公司主营业务不涉及类金融业务。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可能涉及财务性投资的报表科目情况如下：

单位：万元

序号	项目	账面价值	是否涉及财务性投资
1	衍生金融资产	19.50	否
2	其他应收款	9,021.24	否
3	其他流动资产	98,981.40	否
4	长期股权投资	308.81	否
5	其他权益工具投资	8,418.88	否
6	投资性房地产	462.41	否
7	其他非流动资产	181,128.87	否

1、衍生金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司衍生金融资产账面金额为 19.50 万元，具体为尚未交割的远期外汇合约产生的公允价值变动损益。公司为对冲日常经营活动所产生的汇率波动风险，开展了与主营业务密切相关的远期外汇合约业务。以上交易不以投机为目的，均以正常的生产经营为基础，不属于财务性投资。

2、其他应收款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 9,021.24 万元，主要

系由日常经营活动产生的各类押金和保证金、公司代付的员工社保及住房公积金、往来款、员工备用金等，不属于财务性投资。

3、其他流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他流动资产账面价值为 98,981.40 万元，主要为待抵扣增值税进项税，不属于财务性投资。

4、长期股权投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司长期股权投资为持有上海合颖 20%的股权。上海合颖成立于 2012 年，系由时任 CPCA 协会环保分会副会长单位江西金达莱环保股份有限公司牵头，联合时任 CPCA 协会副理事长单位汕头超声印制板公司、时任 CPCA 协会副理事长单位及环保分会会长单位恩达电路（深圳）有限公司及深南电路共同出资设立。公司持有上海合颖 20%股权系战略性投资，公司根据章程规定参与该公司重要经营决策，对该项投资采用权益法核算，截至 2026 年 6 月 30 日，确认长期股权投资账面价值 308.81 万元。公司该项股权投资不以获取投资收益为主要目的，不属于财务性投资。

5、其他权益工具投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他权益工具投资为所持两家公司的少数股权，具体情况如下：

单位：万元

项目	账面价值	持股比例	投资类型	投资时间
华进半导体	7,685.65	2.08%	战略性投资	2012-9-29
汇芯通信	733.23	2.95%	战略性投资	2019-3-29

（1）华进半导体

华进半导体成立于 2012 年，系由公司与中国科学院微电子研究所、江苏长电科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司等封测领域知名企业及研究所共同设立，旨在建立具有国际影响力的半导体封测技术研发中心，以提升我国半导体封测产业技术创新能力与核心竞争力。

华进半导体的主营业务为集成电路封装与系统集成的技术研发，服务范围包括设计仿真、先进封装技术及测试服务，与公司封装基板业务同属集成电路领域，

该投资有利于公司接触行业前沿技术并加强与同行业交流合作，在业务上发挥战略协同效应，该投资能够加快公司封装基板业务规模化的进程。因此，该投资不属于财务性投资。

（2）汇芯通信

汇芯通信成立于 2019 年，主要业务为集成电路设计、研发、销售、技术服务，系由深圳市福田区人民政府、清华大学、南方科技大学联合多家 5G 产业链上下游的龙头企业和上市公司发起成立，专注于 5G 通信领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转化推广和首次商业化的高科技公司。汇芯通信已获批“国家 5G 中高频器件创新中心”并成功发起组建了覆盖全国的 5G 产业技术联盟。公司对汇芯通信的投资有利于产业链的延伸和拓展。因此，公司对汇芯通信的投资系围绕主营业务及未来发展战略而进行的战略性投资，不以获取投资收益为主要目的，不属于财务性投资。

6、投资性房地产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司投资性房地产的账面价值为 462.41 万元，系公司位于深圳市福田区深南中路中航苑及福田区车公庙泰然六路的部分闲置自有房产。在确保生产经营有序开展的前提下，为提高公司资产使用效率，公司将相关房产对外出租获取收益。前述房产不以获取中短期财务价值为主要目的，公司目前暂无出售投资性房地产的计划，不属于财务性投资。

7、其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产账面价值为 181,128.87 万元，主要为预付工程设备款，不属于财务性投资。

综上所述，截至最近一期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形。

（三）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）的情况

2026 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第十七次会议首次审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案；自本次发行首次董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资或类金融业务的情形。

八、同业竞争情况

（一）同业竞争情况

发行人的控股股东深天科技控股为控股型公司，其下属子公司主要从事显示器及模组制造、印制电路板制造、计时仪器及精密制造、供应链管理服务、汽车零部件及配件制造、工程管理服务等业务。其中，印制电路板业务系通过发行人开展。除发行人外，深天科技控股及其控股企业未从事与发行人主营业务产品相同或相似产品的研制、生产及销售业务，与发行人不存在同业竞争。

发行人的实际控制人航空工业集团为控股型公司，其下属控股企业的主营业务均有明确的定位和划分，通过业务专业化分类，从而有效避免集团内部企业之间竞争。

综上，发行人与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不存在同业竞争的情形。

（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，实际控制人航空工业集团出具以下承诺：

“（一）除深南电路外，本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营业务相同或类似的业务，与深南电路不构成同业竞争。本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，以避免与深南电路构成同业竞争。

（二）本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务，本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决。

（三）若因本公司或深南电路的业务发展，而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞争，本公司承诺，深南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或本公司通过合法途径促使本公司所控制的

全资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权，或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与深南电路的业务构成同业竞争。

在本公司为深南电路实际控制人期间，上述关于避免同业竞争的承诺持续有效。”

为避免同业竞争，控股股东深天科技控股出具以下承诺：

“（一）除深南电路外，本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营业务相同或类似的业务，与深南电路不构成同业竞争。在深南电路依法存续且本公司为深南电路第一大股东或持有深南电路 5%以上股份的情况下，本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，以避免与深南电路构成同业竞争。

（二）本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务，本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决。

（三）在本公司仍然为深南电路第一大股东或持有深南电路 5%以上股份的期间，若因本公司或深南电路的业务发展，而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞争，本公司承诺，深南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权，或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与深南电路的业务构成同业竞争。

（四）本公司确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出；本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本公司违反上述承诺而给深南电路造成损失的，本公司同意对由此而给深南电路造成的损失予以赔偿。

在本公司为深南电路控股股东期间，上述关于避免同业竞争的承诺持续有效。”

九、重大未决诉讼、仲裁情况

截至报告期末，发行人不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的涉案金额占发行人最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件，也不存在尚未了结的对发行人生产经营、财务状况、募投项目实施产生重大不利影响的诉讼或仲裁案件。

十、报告期内发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否存在行政处罚、纪律处分

公司现任董事、高级管理人员最近三年不存在受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形。

公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形。

公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

十一、报告期内交易所对发行人年度报告的问询情况

公司分别于 2025 年 4 月、2026 年 7 月收到深交所下发的年报问询函，公司就相关问题进行了逐项落实，并完成了年报问询函回复。除此之外，报告期内公司不存在其他深交所对年度报告问询的情形，不存在年报多次问询的事项。

第三节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景与目的

（一）本次发行的背景

1、国家政策大力支持，推动 PCB 产业加速发展

2026 年 3 月 13 日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（以下简称“《纲要》”）将科技创新置于国家发展全局的核心位置，明确提出要优化提升传统产业，培育壮大新兴产业和未来产业，巩固壮大实体经济根基，推动科技创新与产业创新深度融合。《纲要》特别强调，要加快人工智能等数智技术创新应用，强化算力、算法、数据等要素高效供给，打造具有国际竞争力的新兴支柱产业；加快低空经济等战略性新兴产业集群发展；前瞻布局具身智能、第六代移动通信（6G）等未来产业，培育新的经济增长点。

印制电路板（PCB）作为电子信息产业的“基石”，是集成电路、人工智能、移动通信、低空经济等战略性新兴产业及未来产业集群不可或缺的核心基础载体。提升 PCB 产业创新体系整体效能，对于夯实我国电子工业基础、加快形成新质生产力具有至关重要的战略支撑作用。

2、全球 PCB 行业市场空间广阔，需求稳步增长

随着 PCB 下游应用领域需求增加，全球 PCB 行业保持稳步增长，行业市场空间广阔。从中长期来看，PCB 行业维持稳定增长态势。根据 Prismark 的数据，2025 年全球 PCB 产值为 858.36 亿美元，同比增长 16.7%，预计 2025 年至 2030 年全球 PCB 产值年复合增长率将达到 11.0%，至 2030 年，全球 PCB 产值将达到 1,446.10 亿美元。分产品结构来看，高端产品增速显著高于行业平均水平，18 层及以上高多层板、HDI 板 2025 年至 2030 年复合增速预计分别为 30.3%、13.1%。

（二）本次发行的目的

1、助力 AI 算力基础设施建设，加快发展新质生产力

2026 年 3 月，《纲要》将“提升数智化发展水平”单独成篇，明确将算力基础设施定位为新质生产力核心引擎与数字中国建设底座，提出构建全国一体化

算力网、加快超大规模智算集群建设的核心部署。本次发行募集资金拟投资建设无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目，该项目核心产品为应用于 AI 服务器、交换机的高速高密高多层 PCB 产品，精准匹配智算基础设施的技术要求，通过扩大高端产能供给，助力我国算力体系建设，推动新质生产力发展。

2、市场需求高速增长，紧抓行业发展机遇

人工智能技术与产业数字化推动全球算力需求飙升，数据中心、AI 服务器、交换机市场迎来快速增长。AI 产业的高速发展带动 PCB 技术加速迭代，产品向高速、超精密、超高层数方向升级。本次募投项目的建设是公司为响应 AI 产业市场需求做出的重大战略举措，将扩大公司现有高速高密高多层 PCB 产品产能。本次发行将进一步加强公司在 AI 算力相关产品和技术的布局，助力公司紧抓行业发展机遇。

3、巩固行业市场地位，提升市场竞争力

本次向特定对象发行股票将显著增强公司资本实力，是公司巩固行业领先地位、实现长期可持续发展的重要战略安排。通过本次发行，公司将提升生产能力以匹配市场增长需求，同时顺应国家产业政策，进一步降低经营风险、扩大市场占有率，提升技术实力，增强综合竞争力。

4、优化公司财务结构，为持续发展提供资金保障

PCB 行业技术迭代快、设备投入大，是典型的资金密集型行业。近年来，公司经营与生产规模稳步扩张，新增产能陆续落地。公司持续以自有资金投入产线建设与技术研发，资金支出相应增加，整体资金需求明显上升。截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 55.67%。通过本次向特定对象发行股票，公司将有效增强资本实力，优化资产负债结构，降低财务费用与财务风险，为公司后续业务发展提供充足的资金保障。

二、发行对象及与发行人的关系

本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境

外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

截至本募集说明书出具日，本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

三、本次发行方案概要

（一）本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，发行对象全部以现金方式认购。公司将在获得中国证监会关于本次发行注册文件的有效期内择机发行。

（三）定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，以下简称“发行底价”）。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行注册批文后，根据询价结果由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生分红派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行底价

将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

（四）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

（五）发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 **204,340,198** 股（含本数）股票。若公司在董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、股份回购注销等事项引起公司股份变动，则本次向特定对象发行的股票数量将视情况依法做相应调整。

在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东会的授权于发行时根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。最终发行数量上限以中国证监会注册文件的要求为准。

（六）限售期

本次向特定对象发行完成后，发行对象通过本次向特定对象发行认购的公司股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（七）上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。

（八）本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排

为兼顾新老股东的利益，本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

（九）本次向特定对象发行股票决议有效期

本次向特定对象发行股票的决议自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（十）本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的相关规定

《注册管理办法》第四十条规定，上市公司应当“理性融资，合理确定融资规模”。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条规定：

1、上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十。

2、上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。

3、实施重大资产重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时须运行一个完整的会计年度。

4、上市公司应当披露本次证券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向，并结合前述情况说明本次发行是否“理性融资，合理确定融资规模”。

公司本次向特定对象发行的股票数量不超过 **204,340,198** 股（含本数），未超过本次发行前总股本的 30%，符合上述第一项的规定。

公司前次募集资金到位时间为 2022 年 1 月 28 日，本次向特定对象发行股票议案已经公司第四届董事会第十七次会议首次审议通过，首次董事会决议日为 2026 年 6 月 12 日，距离前次募集资金到位日的时间间隔超过 18 个月，符合上述第二项的规定。

公司本次向特定对象发行股票，不适用上述第三项的规定。

公司已在本募集说明书“第三节 本次证券发行概要”、“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”、“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中披露本次证券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向，本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”，符合上述第四项的规定。

综上，本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的相关规定。

四、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书出具日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书出具日，深天科技控股持有公司 426,489,271 股股份，占公司股份总数的 62.61%，为公司控股股东；中航产投持有公司 1,811,929 股股份，占公司股份总数的 0.27%，中航产投系航空工业集团控制的企业，航空工业集团通过深天科技控股及中航产投间接合计控制公司 62.88%股份，为公司实际控制人。

本次发行前后，公司的控股股东均为深天科技控股，实际控制人均为航空工业集团。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

六、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件

本次发行不会导致公司的股权分布不具备上市条件。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）已履行的批准程序

2026 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过本次向特定对象发行股票相关事项。

2026 年 7 月 7 日，航空工业集团作出《关于深南电路股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》（航空资本［2026］480 号），同意公司本次发行方案。

2026年8月14日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事项。

2026 年 9 月 8 日，根据 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过本次向特定对象发行股票相关调整事项。

本次向特定对象发行股票方案已经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册。

（二）尚需履行的批准程序

公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

（一）本次募集资金规模及投向

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 436,735.20 万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金
1	无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目	无锡深南	453,630.84	360,000.00
2	补充流动资金	深南电路	76,735.20	76,735.20
合计			**530,366.04**	**436,735.20**

在本次向特定对象发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序予以置换。本次募集资金不存在包含首次董事会决议日前已投入资金的情况。

在本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会及其授权人士将在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。

（二）募集资金投资项目是否涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业

本次募投项目产品为公司现有产品高速高密高多层 PCB。公司本次发行的募集资金投资项目不属于《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2020〕901 号）、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7 号）等文件认定的产能过剩行业范围。公司本次发行的募集资金投资项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》限制类、淘汰类行业。

（三）新增大量固定资产或无形资产对发行人经营业绩的影响

本次募集资金投资项目建成后，公司的固定资产、无形资产较本次发行前有较大规模的增加，由此带来每年固定资产折旧、无形资产摊销的增长。同时，由于本次募集资金投资项目建成后存在产能爬坡、市场逐步开拓的周期，虽然项目预计效益可以覆盖折旧摊销的影响，但募投项目建成后折旧与摊销费用的增加仍可能在短期内影响发行人的经营业绩。

二、本次募集资金使用的具体情况

（一）无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目

无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目预计总投资 453,630.84 万元，拟使用募集资金 360,000.00 万元，规划建设期 1 年。本项目的实施主体为无锡深南，地点位于江苏省无锡市，拟生产用于 AI 服务器、交换机等领域的高速高密高多层 PCB 产品。

1、项目概况

项目名称	无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目
建设地点	江苏省无锡市新吴区
实施主体	无锡深南电路有限公司
建设内容	本项目主要生产公司现有高速高密高多层 PCB 产品，用于 AI 服务器、交换机等领域
项目建设期	1 年
项目总投资	453,630.84 万元
拟使用募集资金投入金额	360,000.00 万元

2、项目实施的必要性

（1）助力 AI 算力基础设施建设，加快发展新质生产力

2026 年 3 月，《纲要》将“提升数智化发展水平”单独成篇，明确将算力基础设施定位为新质生产力核心引擎与数字中国建设底座，提出构建全国一体化算力网、加快超大规模智算集群建设的核心部署。本次发行募集资金拟投资建设 AI 算力电子电路产品项目，核心产品为应用于 AI 服务器、交换机的高速高密高多层 PCB 产品，精准匹配智算基础设施的技术要求，通过扩大高端产能供给，助力我国算力体系建设，推动新质生产力发展。

（2）紧抓行业发展机遇，满足下游客户日益增长的需求

算力需求的爆发，驱动 AI 服务器、交换机市场高速增长，进而带动 AI 服务器、交换机对高性能计算和高速数据传输的需求不断提升，亦推动了 PCB 技术的快速迭代。为满足高负载、高速运算需求，PCB 产品需具备高密度互联、多层设计和高速信号传输能力。AI 的快速发展带动了下游硬件升级需求的快速增加，对 PCB 集成度要求与信号完整性要求不断增加。本次募投项目将进一步加强公司在 AI 算力相关产品和技术的布局，助力公司紧抓行业发展机遇。

公司 PCB 产品已广泛应用于 AI 服务器及交换机领域，深度配套 AI 服务器与交换机头部厂商。公司相关产品产能利用率高，通过本次募投项目扩大高速高密高多层 PCB 产品产能，以满足下游客户日益增长的需求。

（3）巩固和提升公司核心竞争力，为股东带来持续稳定的价值增长

高端 AI 服务器、交换机 PCB 产品技术迭代显著快于传统 PCB，且对高速信号完整性、多层压合精度、散热性能等要求显著提升，具有较高的技术壁垒和客户认证壁垒，先发优势和技术积累是企业核心竞争力的关键，持续投入研发与产能建设是维系行业地位的重要保障。本次募投项目将进一步提升公司 AI 服务器、交换机 PCB 产能和技术能力，优化公司产品结构，进一步强化与头部厂商的深度绑定，巩固公司在该产业链中的核心地位，为股东带来持续稳定的价值增长。

3、项目实施的可行性

（1）目标市场空间广阔，前景良好

受益于人工智能的发展与数据中心需求的快速增长，服务器与交换机市场需求强劲，带动高速高密高多层 PCB 等市场需求快速增长。根据 Prismark 的数据，2025 年全球服务器/数据存储领域 PCB 市场规模为 160.31 亿美元，同比增长 46.9%；预计 2030 年全球服务器/数据存储领域 PCB 产值规模将达到 485.76 亿美元，年复合增长率达到 24.8%。因此，广阔且快速增长的市场需求为本次募投项目的顺利实施提供了充分保障。

（2）自主掌握关键核心技术，具备量产能力

公司长期坚持技术领先战略，以技术发展为第一驱动力，高度重视技术与产品的研发工作，已在 PCB 制造全链条上形成了具有自主知识产权的完整技术体系。公司凭借多年的技术积累和工艺沉淀，已全面掌握高速信号完整性设计、高精度多层压合、激光微盲埋孔等核心技术，产品性能指标达到国际先进水平，能够满足新一代 AI 平台的严苛技术要求。近年来，公司紧跟芯片发展及客户需求，已系统掌握了高速高密高多层 PCB 制造技术，技术储备完善，并已实现批量交付，关键技术符合目标客户需求。截至 2026 年 6 月末，公司员工总数 25,640 人，其中拥有大学本科及以上学历人员 5,980 人，技术人员 5,531 人，培养了一支技术底蕴深厚、实战经验丰富的复合型研发团队，为持续创新提供坚实的人才基础。公司拥有优秀的研发团队和深厚的技术储备，具备募投产品量产能力，为本次募投项目的顺利实施提供了可靠保障。

（3）具备较高市场地位，客户合作关系长期稳定

公司作为国内 PCB 行业的头部企业，在 AI 服务器、交换机 PCB 等领域已建立显著市场优势。高端 AI 算力 PCB 领域客户认证壁垒较高，进入全球头部厂商供应链需经过严格审核，涵盖质量体系、产品可靠性、批量交付能力、技术研发实力等多维度验证，一旦通过认证便形成较强的客户粘性，合作关系长期稳定。公司已与多家头部 AI 服务器厂商、交换机厂商、云服务商及芯片企业建立了深度战略合作关系。公司现有 AI 算力 PCB 产品订单饱满，核心客户产能需求意向明确，为本次募投项目建成后的产能消化提供了坚实保障。

4、项目投资概算

本项目计划总投资 453,630.84 万元，拟使用本次向特定对象发行股票募集资金 360,000.00 万元，投资明细如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资占比	拟使用募集资金投入金额
1	**建设投资**	**427,753.00**	**94.30%**	**360,000.00**
1-1	生产设备购置费	280,000.00	61.72%	360,000.00
1-2	工程建设费用	140,753.00	31.03%	

1-3	土地购置费	7,000.00	1.54%	-
2	**建设期利息**	**1,764.21**	**0.39%**	**-**
3	**铺底流动资金**	**24,113.63**	**5.32%**	**-**
项目总投资		**453,630.84**	**100.00%**	**360,000.00**

如上表所示，无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目拟使用募集资金总额 360,000.00 万元，均为资本性支出。

5、预计实施时间及整体进度安排

公司本次募投项目“无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目”的实施主要包括工程及设备购置、基础建设及装修工程、设备采购及安装调试、职工培训等工作安排。项目预计建设周期 12 个月，具体建设进度安排如下表所示：

序号	工作内容	建设期（月）											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	项目前期工作	△											
2	初步设计、施工设计、非标设备设计		△	△									
3	土建工程				△	△	△	△	△	△	△	△	△
4	设备购置				△	△	△	△					
5	设备到货检验									△	△	△	
6	设备安装、调试										△	△	△
7	职工培训								△	△	△	△	
8	试运行												△

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

募投项目效益预测系公司基于当前市场情况对募投项目效益的合理预期，上述效益的实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变化等多种因素。

根据测算，本项目建成后，所得税后财务内部收益率为 11.12%，所得税后静态投资回收期为 9.17 年（含建设期）。本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

（1）营业收入

本项目主要产品为用于 AI 服务器、交换机等领域的高速高密高多层 PCB 产

品，产品价格以当前市场价格及未来变化趋势作为主要测算依据，销售数量根据所建工厂的配套生产能力及未来市场需求进行估算。

（2）营业成本

项目营业成本包括原材料成本、人工成本、生产制造成本、折旧费用和燃料及动力费用等。原材料成本参考主要原材料市场价格；直接人工费根据项目拟投入人员数量，参考公司当前同岗位平均工资水平，结合当地未来人工上涨的趋势进行估算；折旧费根据项目新增固定资产金额，参考公司现行的会计政策计提；其他制造费用等参考公司历史财务数据进行测算。

（3）期间费用

项目期间费用中的人工费用根据项目拟投入管理行政等相关人员数量，参照当前同岗位平均工资水平，结合未来涨幅趋势进行测算，项目期间费用中各项费用根据公司同类型生产工厂历史财务数据中各项费用占营业收入的比例进行测算。

7、效益指标的合理性

本次发行募集资金拟投资建设无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目，核心产品为应用于 AI 服务器、交换机的高速高密高多层 PCB 产品，本次募投项目与公司报告期内毛利率的对比情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
公司印制电路板业务毛利率	36.85%	35.53%	31.62%	26.55%
报告期平均值	32.64%			
无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目达产年平均毛利率	25.19%			

如上表所示，无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目达产年测算的平均毛利率为 25.19%，略低于公司印制电路板报告期内毛利率平均值，公司本次募投项目达产年测算的毛利率水平具有谨慎性、合理性。

8、项目用地、备案、环评情况

公司已取得本项目所需用地的土地使用权，证书编号：苏（2025）无锡市不动产权第 0192704 号。

本项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律、法规和规章的规定，截至本募集说明书出具日，本次募投项目已取得无锡高新区（新吴区）数据局出具的《江苏省企业投资备案证》（项目代码：2508-320214-89-02-386715）、无锡市数据局出具的《关于无锡深南电路有限公司无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目环境影响报告表的批复》（锡数环许〔2026〕7098 号）、江苏省发展改革委出具的《省发展改革委关于无锡深南电路有限公司无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目节能报告的审查意见》（苏发改能审〔2026〕68 号）；本次募投项目涉及的上述备案或审批仍在有效期以内，均合法、有效。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟使用不超过 76,735.20 万元募集资金用于补充流动资金，以满足公司主营业务持续发展以及未来业务规模扩张的资金需求。

2、项目的必要性

（1）满足公司业务发展的资金需求，增强持续经营能力

公司所处的印制电路板制造行业属于资本和技术密集型产业，对资金投入的需求较高，且近年来公司业务保持较快增长，资金需求较大。公司拟将本次向特定对象发行的募集资金 76,735.20 万元用于补充流动资金，将在一定程度上满足公司资金的需求，更好支持公司业务发展，增强公司的可持续经营能力。

（2）优化公司资本结构，提高抗风险能力

报告期各期末，公司资产负债率分别为 41.67%、42.12%、43.82%及 55.67%，呈逐年上升趋势。补充流动资金不仅有利于解决公司快速发展过程中的资金需求，也有利于公司优化资本结构和改善财务状况。本次发行完成后，公司的资产负债率将进一步降低，有利于优化公司的资本结构、降低流动性风险、提高公司抗风险能力。

3、项目的可行性

（1）本次发行的募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善资本结构，降低财务风险，有效缓解公司经营活动扩张的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

（2）公司已建立完善的募集资金使用管理制度并有效运行

公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。

公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

4、补充流动资金规模的测算

假设2026年至2028年，公司主营业务、经营模式及各项财务指标保持稳定，各项流动资产和流动负债与营业收入保持稳定的比例关系，营业收入维持2023年至2025年的年复合增长率32.22%作为前提。

用营业收入百分比法，测算未来营业收入增长所引起的经营性流动资产（应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、存货）和经营性流动负债（应付票据、应付账款、预收款项、合同负债）的变化，测算2026-2028年度公司的营运资金缺口，具体测算过程如下：

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年末		2026 年度/2026 年末	2027 年度/2027 年末	2028 年度/2028 年末
	金额	占收入比例			
营业收入	**2,364,697.71**	**100.00%**	**3,126,597.07**	**4,133,978.38**	**5,465,935.30**
应收票据	55,231.49	2.34%	73,026.93	96,556.02	127,666.11
应收账款	524,986.23	22.20%	694,135.40	917,784.00	1,213,491.58
应收款项融资	86,697.26	3.67%	114,630.89	151,564.65	200,398.39
预付款项	3,563.88	0.15%	4,712.16	6,230.40	8,237.82
存货	513,970.16	21.74%	679,569.98	898,525.64	1,188,028.22

项目	2025 年度/2025 年末		2026 年度/2026 年末	2027 年度/2027 年末	2028 年度/2028 年末
	金额	占收入比例			
经营性资产合计	**1,184,449.02**	**50.09%**	**1,566,075.36**	**2,070,660.71**	**2,737,822.12**
应付票据	169,090.48	7.15%	223,570.98	295,604.96	390,848.10
应付账款	393,438.17	16.64%	520,202.90	687,810.91	909,421.76
预收款项	154.70	0.01%	204.55	270.46	357.60
合同负债	17,289.53	0.73%	22,860.17	30,225.66	39,964.29
经营性负债合计	**579,972.88**	**24.53%**	**766,838.61**	**1,013,911.99**	**1,340,591.75**
流动资金需求	**604,476.14**	**25.56%**	799,236.75	1,056,748.72	1,397,230.37
年度流动资金增加需求			194,760.61	257,511.97	340,481.65
营运资金缺口合计					**792,754.23**

以2025年数据作为测算基础，公司未来三年营运资金需求缺口为792,754.23万元。

5、本次发行补充流动资金规模符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》规定：“通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十”。

本次募投项目为“无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目”，主要生产公司现有高速高密高多层 PCB 产品，用于 AI 服务器、交换机等领域。项目总投资金额为 453,630.84 万元，拟使用募集资金投入金额为 360,000.00 万元，募集资金投入金额对应建设内容为生产设备购置费及工程建设费用等，均为资本性支出。

本次募集资金中拟用于补充流动资金的金额为 76,735.20 万元，占拟募集资金总额的比例为 17.57%，未超过募集资金总额的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展战

略，有利于公司把握市场机遇，扩大业务规模，优化业务结构，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。本次募集资金投资项目系公司现有产品扩产，具备良好的市场发展前景和经济效益。本次向特定对象发行募集资金投资项目完成后，公司综合竞争力将进一步得到提升，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司的总资产和净资产将进一步增加，资产负债率将下降，抗风险能力将得到提升，有利于增强公司的资本实力。

本次募集资金投资项目有较好的经济效益，有利于提高公司的持续盈利能力。募集资金投资项目产生效益需要一定时间，在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着相关项目效益的逐步实现，公司的盈利能力有望在未来得到进一步提升。

四、募集资金投向与现有业务或发展战略的关系

公司专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。其中，在印制电路板业务方面，公司专业从事中高端印制电路板的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。公司 PCB 产品已广泛应用于 AI 服务器及交换机领域，并已与多家头部 AI 服务器厂商、交换机厂商、云服务商及芯片企业建立了深度战略合作关系。

本次向特定对象发行的募集资金在扣除发行费用后拟用于无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目以及补充流动资金。募集资金投向围绕公司 PCB 主业，项目聚焦公司现有高速高密高多层 PCB 产品，精准匹配智算基础设施的技术要求，通过扩大高端产能供给，响应下游客户日益增长的需求，不涉及新业务、新产品。无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目将进一步加强公司在 AI 算力相关产品和技术的布局，助力公司紧抓行业发展机遇，提升公司的核心竞争力；补充流动资金有利于增强公司资本实力，优化资产负债结构，降低财务费用与财务风险，为公司后续业务发展提供充足的资金保障。

五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）发行人的实施能力

1、人员储备情况

公司注重人才队伍建设，已建立涵盖招聘、梯队培养、绩效激励等在内的全链条人力资源管理体系，在管理、研发、生产、销售等核心领域储备了充足的专业化人才，形成了结构合理、经验丰富的人才梯队，为公司持续经营与项目落地奠定坚实人力基础。截至 2026 年 6 月末，公司员工总数 25,640 人；按学历结构划分，大学本科及以上学历人员有 5,980 人，占比为 23.32%；按专业分工划分，技术人员有 5,531 人，占比为 21.57%。未来公司将根据募集资金投资项目的人员配置要求，通过内部培养和外部优秀人才的招聘，继续加强人力资源建设，为募投项目的顺利实施提供保障。

2、技术储备情况

公司已成为中国电子电路行业的领先企业、中国封装基板领域的先行者、电子装联特色企业，系国家高新技术企业、中国电子电路行业协会理事长单位及标准委员会会长单位，技术实力稳居行业前列。公司业务近年紧跟客户需求，长期保持高强度研发投入，已对高速高密高多层 PCB 技术拥有完善储备，相关关键技术符合目标产品需求。经过多年的自主研发和创新，公司已取得多项与核心产品相关的专利技术，从工艺技术到前沿产品开发全方位保持着技术领先优势。凭借领先的研发能力和丰富的技术积累，公司具备了较强的技术实力，为本次项目的成功实施提供了有力的技术保障。

3、市场储备情况

公司坚持以客户需求为导向，将 AI 服务器和交换机市场作为核心市场之一，与行业龙头企业保持紧密合作，持续优化和升级产品结构，积极配合终端客户进行相关产品的开发工作。目前存量客户产能诉求意愿强烈，已对公司相关产品提出需求，同时公司已和多家 AI 服务器厂商、交换机厂商、云服务商及芯片企业保持长期稳定合作关系，公司新建募投项目涉及的高速高密高多层 PCB 产品具备良好发展前景。

综上，公司在人员、技术和市场等方面具有丰富的储备，能够为本次发行募

集资金投资项目的实施提供有力保障。

（二）资金缺口的解决方式

本次募集资金投资项目总投资金额为 530,366.04 万元，拟使用募集资金投入 436,735.20 万元，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。本次募集资金到位前，公司将根据项目进展情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，根据相关法规要求予以置换。

六、关于“两符合”和不涉及“四重大”相关规定

公司本次发行满足《上市公司证券发行注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

（一）本次发行满足“两符合”的相关规定

1、符合国家产业政策的情况

公司目前主要从事印制电路板、封装基板及电子装联三项业务，其中 2025 年度印制电路板业务营收占比为 60.73%。公司印制电路板业务产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域，主要产品包括高速多层板、HDI、背板、高频微波板及多功能金属基板等。公司本次募投项目围绕公司现有主业展开，旨在对公司现有的高速高密高多层 PCB 产品进行扩产。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“制造业” 之“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”之“电子电路制造”，行业代码为 C3982；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”项下的“新型电子元器件及设备制造”行业。

公司业务不属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中产能过剩行业或限制类、淘汰类行业，公司本次发行募集资金用于无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目，该项目主要生产公司现有高速高密高多层 PCB 产品，用于 AI 服务器、交换机等领域，投资于主营业务，符合国家产业政策要求。

2、本次募集资金主要投向主业

本次募集资金扣除发行费用后拟用于“无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目”和补充流动资金。关于公司本次募投项目属于投向主业的分析如下：

认定标准	判断标准	具体分析	结论
关于“现有主业”的认定	“现有主业”原则上应当以公司披露再融资方案时点为基准进行认定，是指有一定收入规模、相对成熟、稳定运行一段时间的业务。募投项目如涉及未能达到一定收入规模或者新开展的业务，应当结合收入发展趋势、业务稳定性和成长性等进行审慎论证。	（1）收入规模：公司本次募投项目产品为高速高密高多层 PCB，系公司已有产品类型。 （2）成熟程度：公司已具备本次募投项目生产所需的相应的技术、人员、设备能力，同类产品已有持续的销售，业务成熟。 （3）稳定运行：针对本次募投项目，公司已形成稳定的供应链体系、生产运营体系和客户合作关系，并与供应商和客户持续开展业务合作。	本次募投项目涉及的业务属于现有业务，已具备一定收入规模、相对成熟、稳定运行，满足关于“现有主业”的认定。
关于募集资金投向“新产品”是否属于“主要投向主业”	对于募集资金投向新产品的，应当结合是否为基于现有产品技术升级或拓展应用领域、拓展现有业务上下游的情形进行论证。一是在原材料采购、产品生产、客户拓展等方面与现有主业具有协同性；二是新产品的生产、销售不存在重大不确定性。对于募投项目与现有主业在原材料、技术、客户等方面不具有直接协同性的，原则上认定为跨界投资，不属于投向主业。	公司本次募投项目产品属于公司现有产品，不涉及新产品。	本次募投项目产品系公司现有高速高密高多层 PCB 产品，属于印制电路板业务，系公司现有主业范畴，不涉及投向新产品的情况。
关于“募投项目实施不存在重大不确定性”	募投项目涉及新产品的，上市公司及中介机构应当结合所处行业特点、技术和人员储备、研发进展情况、产品测试、客户送样、市场需求和销售渠道等充分论证募投项目实施不存在重大不确定性。新产品有试生产程序的，原则上应当中试完成或达到同等状态，同时对项目最终能否获得客户认证等相关风险进行重大风险提示。	公司本次募投项目产品属于公司现有产品，不涉及新产品。	本次募投项目的实施不存在重大不确定性。

综上所述，发行人本次募投项目涉及的业务属于现有主业，符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

（二）本次发行不涉及“四重大”

截至本募集说明书出具日，发行人主营业务及本次发行募投项目不涉及情况特殊、复杂敏感、审慎论证的事项；公司本次发行不存在重大无先例事项；不存在影响本次发行的重大舆情；未发现公司存在相关投诉举报、信访等重大违法违规线索，本次发行满足《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

综上所述，本次发行满足“两符合”，不涉及“四重大”，满足《注册管理办法》第三十条、《证券期货法律适用意见第 18 号》以及《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

七、募集资金使用可行性分析结论

本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力。本次募集资金用途符合相关政策和法律法规，符合公司及全体股东的利益，具备必要性和可行性。

八、关于发行人最近五年内募集资金使用情况

（一）前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，公司 2021 年度非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94 元。

上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。

（二）前次募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相应募集资金专户均已注销。

（三）前次募集资金使用情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司前次募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：			252,966.48			已累计使用募集资金情况				
						各年度使用募集资金总额		259,274.44		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			2022 年度：		160,421.66		
累计变更用途的募集资金总额			-			2023 年度：		32,557.91		
累计变更用途的募集资金总额比例：			-			2024 年度：		10,645.46		
						2025 年度：		55,649.40		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目	高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目	180,000.00	180,000.00	131,312.76	180,000.00	180,000.00	131,312.76	48,687.24	2022 年 9 月 30 日
2	补充流动资金	补充流动资金	75,000.00	72,966.48	73,196.88	75,000.00	72,966.48	73,196.88	-230.40	不适用
3	——	永久补流	——	——	54,764.80	——	——	54,764.80	-54,764.80	不适用
合计			255,000.00	252,966.48	259,274.44	255,000.00	252,966.48	259,274.44	-6,307.96	——

注：1、“达到预定可使用状态”系指项目连线试生产后，即已能够正常生产出合格产品时。

2、补充流动资金的募集前承诺投资金额和募集后承诺投资金额差异系支付相关发行费用，补充流动资金的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-230.40 万元，系专户存款利息扣除银行手续费的净额用于该项目的支出。

3、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-6,307.96 万元，差异原因系公司闲置募集资金现金管理收益和专户存款利息扣除银行手续费后的净额用于该项目的支出。

4、2025 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目”节余募集资金用于永久补充流动资金。报告期内，公司使用“高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目”节余募集资金 54,764.80 万元（包括累计收到的投资收益和银行存款利息并扣减手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。该项目出现募集资金结余并用于永久补流的原因具体为：

①2023 年公司根据业务发展需要，将无锡深南持有的涉及封装基板业务的相关资产无偿划转至无锡广芯，划转的封装基板业务包括高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目，厂房不在划转范围内，建设厂房部分款项使用自有资金支付；此外，在项目推进过程中，公司结合实际资金需求和规划，统筹安排资金来源，对部分阶段性资金需求先行使用自有资金支付；

②募投项目部分合同余款支付时间周期较长，部分尾款尚未支付，公司将按约定继续支付；

③在不影响募投项目实施和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理及活期存款产生了一定的收益；

④在项目实施过程中，公司结合下游市场和项目实际情况，在满足现阶段的实际需求前提下，按需增设设备资源，在募集资金计划投入范围内缩减了一定投入金额，该部分金额较小。

（四）前次募集资金变更情况

2023 年，根据公司业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，经有权国资监管单位审核，公司将无锡深南持有的涉及封装基板业务的相关资产无偿划转至无锡广芯，本次划转的封装基板业务包括“高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目”，因此募投项目实施主体由全资子公司无锡深南变更为全资子公司无锡广芯。本次资产划转属于公司内部资源整合优化，不涉及现金支付，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

前次募投项目实施主体变更前后均为公司全资子公司，不会对公司财务状况造成不利影响，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的整体规划和合理布局，进一步夯实公司战略，促进公司高质量、可持续发展。

2023 年 6 月 13 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司“高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目”实施主体由全资子公司无锡深南变更为全资子公司无锡广芯。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。

（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本节“八、关于发行人最近五年内募集资金使用情况”之“（三）前次募集资金使用情况”。

（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目无对外转让的情况。

2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 42,092.68 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并由其出具了信会师报字[2022]第 ZI10019 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，

独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。公司于 2022 年 2 月完成了募集资金置换。

（七）闲置募集资金情况说明

2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用不超过人民币 13.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款。使用期限自董事会审议通过后一年内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型产品。使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过 5.60 亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。

截至 2026 年 5 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，且都已到期，到期赎回的本金和收益已归还至募集资金专户，不存在尚未到期的理财产品。

（八）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2026 年 5 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目	不适用	达产年均净利润为 21,516 万元	不适用 [1]	不适用 [1]	不适用 [1]	不适用	不适用 [2]
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 [3]
3	永久补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 [3]

注：1、高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目在 2023 年至 2025 年内处于爬坡阶段，尚未进入完整达产年度，产能与效益尚未完全释放；

2、高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目按项目达产年年度口径承诺效益，2026 年 1-5 月非完整会计年度，故实际效益情况为不适用；本项目达产后正常经营年份年均净利润为 21,516 万元，2026 年 1-5 月项目净利润为 16,769 万元，已实现达产年完整年度承诺净利润的 78%；

3、补充流动资金与永久补流项目为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，不直接产生经济效益。

（九）会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

容诚会计师于 2026 年 6 月 12 日就公司前次募集资金的运用出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]510Z0676 号），认为：深南电路《深南电路股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了深南电路截至 2026 年 5 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

（一）本次发行对公司业务的影响

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目系围绕公司现有 PCB 业务展开。本次募集资金投资项目实施，有利于提高公司中长期核心竞争力。

本次发行不涉及公司业务与资产的整合。本次发行后，公司总资产规模、净资产规模均将有所提高，公司主营业务范围保持不变。

（二）本次发行对公司章程的修订

本次发行完成后，公司将对《公司章程》中关于公司注册资本（股本）等与本次向特定对象发行相关的事项进行调整，并办理工商变更登记。除此之外，公司暂无就此次发行对《公司章程》其他条款修订的计划。

（三）本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股东结构及持股比例将发生一定的变化，但本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会导致公司高级管理人员结构发生重大变动。公司未来如对高级管理人员结构进行调整，将根据有关规定履行相应的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务收入结构的影响

本次发行完成后，公司主营业务将进一步稳固，有利于提升公司核心竞争力，巩固公司市场地位。公司的主营业务和总体业务结构不会因本次发行发生重大变化。

二、本次发行完成后，公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增

加，财务状况将改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高，整体实力得到增强。本次向特定对象发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下：

（一）对财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。

（二）对盈利能力的影响

本次发行后，公司资本实力得到进一步增强，募集资金投资项目的实施有助于提升公司在所处行业的市场竞争力，提高公司的盈利能力。与此同时，本次发行后公司总股本增加，若公司利润增长幅度小于净资产和股本数量的增长幅度，短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标下降。

（三）对现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将相应增加，用于募投项目投资活动现金流出也将随之上升；随着募集资金投资项目投产和产生效益，预计公司经营性活动产生的现金流量净额将随收入和利润的增长而不断增加。

三、本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会发生实质性变化，亦不会因本次发行产生同业竞争。

本次向特定对象发行募投项目实施后，随着公司业务规模的进一步增长，可能导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间关联交易规模相应扩大，公司将继续按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务，保证该等关联交易的合规性和公允性，使其符合上市公司和全体股东的利益，不损害中小股东利益。

四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行前，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人违规提供担保的情形。

公司不会因为本次发行而产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会因本次发行产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将同时增加，公司的资产负债率将有所下降，公司的偿债能力和抗风险能力将得到有效提升。公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

第六节 与本次发行相关的风险因素

一、市场风险

（一）宏观经济波动风险

PCB 是电子产品的关键电子互连件，下游应用领域广泛，包括服务器/数据存储、手机、通信设备、计算机、汽车电子及其他消费电子等。PCB 行业的发展与电子信息产业及宏观经济形势密切相关。随着电子信息产业国际化程度不断提高，PCB 需求受全球市场环境影响较大。若未来全球地缘政治风险上升，贸易保护主义加剧，宏观经济形势出现波动，或国家财政、货币、贸易等宏观政策发生不利调整，可能对公司经营生产及盈利水平产生一定影响。

（二）市场竞争风险

尽管 PCB 行业近年来保持高景气度，但行业参与者众多，市场竞争较为激烈。受益于下游需求快速增长，部分已上市 PCB 企业利用资金优势积极扩充产能，相关产能逐步释放，未来行业竞争可能进一步加剧。报告期内，公司印制电路板业务毛利率分别为 26.55%、31.62%、35.53%和 36.85%，毛利率上升受益于 AI 算力需求快速增长，若未来下游需求增速放缓或不及预期，而新增产能集中投放，行业竞争加剧，可能导致市场逐步发展为买方市场，PCB 产品价格相应下降，进而对公司毛利率及经营业绩产生不利影响。

二、经营风险

（一）核心技术人才流失风险

核心技术人才是公司生存和发展的重要基石，雄厚的技术人才资源为公司快速发展奠定了良好的基础。若未来公司的技术人才出现流失，且不能吸引相关优秀人才加入，可能影响公司的持续盈利能力。

（二）原材料和设备供应及价格波动风险

公司原材料主要包括覆铜板、半固化片、金盐、油墨和铜箔等。原材料成本占公司产品总成本的比例较高，是公司产品定价的重要影响因素之一。经测算，若原材料成本上涨 10%，本次募投项目达产年平均毛利率将下降 5.14 个百分点。

前述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。目前公司原材料采购渠道畅通、供应情况良好，未来若原材料供需结构变化，导致供应紧张或者价格发生波动、交付延迟，将直接影响公司产品正常生产交付，对公司生产经营及盈利能力造成不利冲击。

此外，公司主要生产设备包括钻孔设备、曝光设备、电镀设备及蚀刻设备等。设备的稳定供应及合理定价是保障产能释放、有序生产的重要基础。若未来行业设备供需格局变化、核心设备出现供应短缺、交付滞后或价格大幅上涨等情况，可能会对公司生产经营及持续发展产生不利影响。

（三）经营规模扩张带来的管理风险

随着公司业务规模扩大，公司在组织架构优化、运营效率提升、内部控制执行及财务管理等方面将面临更多挑战。若公司管理层未能持续提升综合管理能力、优化完善管理体系，将可能无法完全适配公司业务发展节奏，进而对公司的经营效率、盈利能力及持续发展造成不利影响。

三、财务风险

（一）存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 268,634.83 万元、339,499.89 万元、513,970.16 万元和 781,730.22 万元，持续增加且规模较大。PCB 生产工序长，原材料及在产品占存货比重较高，对公司营运资金形成较大占用。若未来宏观经济波动、行业竞争加剧或客户需求发生重大变动，部分存货可能面临积压、滞销，公司进而面临存货跌价损失影响整体利润的风险。

（二）业绩增速放缓甚至业绩下滑的风险

报告期内，公司实现营业收入 1,352,642.60 万元、1,790,744.53 万元、2,364,697.71 万元和 1,529,636.14 万元，近两年同比增长 32.39%和 32.05%，扣非归母净利润分别为 99,795.39 万元、173,987.26 万元、311,362.75 万元和 223,917.25 万元，近两年同比增长 74.34%和 78.96%，营收与利润均实现快速增长。

未来若下游需求放缓，或出现宏观经济波动、国际贸易环境恶化、行业竞争

加剧、客户开拓不及预期、原材料价格大幅波动等情况，均可能导致公司业绩增速放缓，甚至出现业绩下滑的情况。

（三）应收款项坏账风险

报告期各期末，公司应收票据、应收账款及应收款项融资账面价值合计分别为 389,547.89 万元、508,206.49 万元、666,914.98 万元和 815,791.46 万元，占流动资产的比例为 45.31%、46.82%、48.84%和 42.31%，应收款项的金额及占比较高。随着公司业务规模的不断扩大，应收款项的增长将加大公司的营运资金周转压力；同时，若宏观经济形势恶化、行业景气度下降，或下游客户经营状况出现不利变化，导致应收款项无法按期或足额回收，公司可能面临坏账风险，进而对资金周转效率及经营业绩产生不利影响。

四、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目实施风险

本次募集资金拟用于无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目及补充流动资金。无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目实施涉及工程建设、设备采购、安装调试及人员培训等多个关键环节，项目建设进度受多种因素影响。若因市场环境发生重大变化、设备供应波动、项目组织管理不力等因素影响，项目可能无法按计划如期竣工投产，对项目实施产生不利影响。

（二）募集资金投资项目新增产能消化及效益不及预期风险

本次募集资金投资项目主要为现有产品产能扩张。公司已结合当前产业政策、行业趋势、市场环境、技术水平及自身积累的品牌与客户资源等条件，完成审慎的可行性研究论证，项目具备相应的市场基础与业务支撑。但项目建成投产后，若未来市场需求发生不利变化、行业竞争加剧，可能导致新增产能无法充分消化。近年来，PCB 行业景气度较高，下游应用于 AI 算力领域的 PCB 企业加快产能扩张步伐，预计未来数年行业新增产能将集中释放，若行业新增产能投放进度超过下游需求增长速度，将导致市场供给相对过剩，进一步加大本次募投项目新增产能的消化压力。同时，在项目实施与运营全周期内，产业政策调整、技术迭代加速等不确定因素，均可能导致项目实际经济效益不及预期，进而对公司整体经营业绩产生不利影响。

（三）募集资金投资项目新增折旧摊销的风险

公司本次募投项目无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目将投入较大金额用于设备采购和工程建设等资本性支出，未来每年新增的固定资产折旧、无形资产摊销对公司经营业绩构成一定影响。根据测算，本次募投项目在项目达产年预计将新增折旧摊销金额 30,560.44 万元，占公司 2025 年利润总额比例为 8.43%，对公司业绩的影响较小。

本次募投项目预期效益良好，项目顺利实施后预计能够有效消化新增折旧摊销的影响，但由于项目建设需要一定的周期，若本次募投项目建设过程中公司经营环境发生重大不利变化，新增折旧摊销可能对本次募投项目效益造成不利影响，继而对公司未来经营业绩产生不利影响。

五、向特定对象发行股票项目相关风险

（一）本次发行股票摊薄即期回报的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司的股本规模及净资产规模相应增加。本次募投项目产生效益需要一定时间周期，产生效益之前公司的利润和股东回报仍主要通过现有业务实现，因此本次发行可能会导致公司摊薄即期回报。此外，若公司本次募投项目未能实现预期效益，导致公司未来的收入规模和利润水平未能实现预期的增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降。

（二）发行审批风险

本次发行已获得深交所审核通过**并经中国证监会同意注册**。

（三）股价波动风险

股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受到国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的交易行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并作出审慎判断。

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签署：

杨智勤	邓江湖	郭高航
黄 凯	崔 荣	黄亚英
于洪宇	张汉斌	

深南电路股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签署：

	邓江湖	郭高航
杨智勤	邓江湖	郭高航
黄凯	崔荣	黄亚英
于洪宇	张汉斌	

深南电路股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签署：

杨智勤	邓江湖	郭高航
黄 凯	崔 荣	黄亚英
于洪宇	张汉斌	

深南电路股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签署：

杨智勤	邓江湖	郭高航
黄 凯	崔 荣	黄亚英
于洪宇	张汉斌	

深南电路股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签署：

杨智勤	邓江湖	郭高航
黄 凯	崔 荣	黄亚英
于洪宇	张汉斌	

深南电路股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签署：

张汉斌	黄亚英	崔 荣

深南电路股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签署：

张汉斌	黄亚英	崔　荣

深南电路股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签署：

		崔荣
张汉斌	黄亚英	崔　荣

深南电路股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签署：

张丽君　　楼志勇　　陈　利

缪　桦　　刘　宇　　孙英杰

深南电路股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

二、发行人控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东法定代表人：



李 斌

深天科技控股（深圳）有限公司

2026 年 11 月 9 日

三、发行人实际控制人声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人法定代表人或授权委托人：



刘秉钧

中国航空工业集团有限公司

2026 年 11 月 9 日

中国航空工业集团有限公司

授权委托书

航空委字[2026]096号

委　　托　　人：中国航空工业集团有限公司
法　定　地　址：中国北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
法定代表人：魏应彪
受　委　托　人：刘秉钧

现委托中国航空工业集团有限公司财务资本部副部长刘秉钧为我公司委托代理人。

代理权限：代表中国航空工业集团有限公司按照证券监管要求，授权签署《深南电路股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书》《深南电路股份有限公司实际控制人对证券发行文件的确认意见》《发行人、保荐人及相关主体保证不影响和干扰审核及注册程序的承诺函》。

代理期限：自2026年08月27日至2027年02月16日。

法定代表人
（签字）：

委托人
（盖章）：
2026年08月27日

四、联合保荐人（主承销商）声明

（一）保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

肖 鑫

保荐代表人：

梁嘉烺 银 波

法定代表人（董事长）：

朱 健

国泰海通证券股份有限公司

2026年1月9日

（二）保荐人（主承销商）董事长和总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总经理（总裁）：

朱 健（代）

法定代表人（董事长）：

朱 健

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

四、联合保荐人（主承销商）声明

（一）保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

朱圣洁

保荐代表人：

杨嘉伟 张威然

法定代表人：

戚 侠

中航证券有限公司

2020 年 11 月 9 日

（二）保荐人（主承销商）董事长和总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总经理：

陶志军

董事长：

戚 侠

中航证券有限公司

2016 年 11 月 9 日

五、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：颜 羽

经办律师：王 浩

赵丹阳

2026 年 11 月 9 日

六、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读深南电路股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾，本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

刘 维

签字注册会计师：

周俊超 张鹏鹤

黄静华

（已离职）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年 11月 9日

关于审计人员离职的说明

黄静华（注册会计师证书编号：110100320723）为深南电路股份有限公司2024年度财务报表审计报告（容诚审字[2025]510Z0012号）的原签字会计师之一，因个人原因，其本人已于2025年11月30日离职，无法在本次深南电路股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书会计师事务所声明页签字。

会计师事务所负责人：

刘 维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年 11 月 9 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读深南电路股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZI10029 号）不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对深南电路股份有限公司在募集说明书中引用的上述报告内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

杨志国

签字注册会计师：

章顺文 柴喜峰

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 11 月 9 日

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

（一）董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次向特定对象发行股票外，公司董事会将根据业务发展规划、行业发展趋势、项目投资进度等情况，并结合公司资本结构、融资成本等因素综合考虑未来十二个月是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会增加，但募集资金产生经济效益需要一定的时间。本次募集资金到位后的短期内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的风险。

为保证本次发行的募集资金有效使用，促进公司业务健康、良好的发展，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，增强公司的可持续发展能力，提升公司的业务规模、经营效益，降低即期回报被摊薄的风险，公司将采取如下措施：

1、加强对募集资金监管，保证募集资金合理合法使用

为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并完善了公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司制定的募集资金管理办法针对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序均作出明确规定。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

2、优化业务流程，提升运营效率与成本优势

公司将持续优化业务流程和完善内部控制制度，对各个业务环节进行标准化管理。在日常经营管理中，加强对研发、采购、生产、销售等各个环节流程和制

度实施情况的监控，提升内部管控效能，并同步推进成本控制工作，提升公司资产运营效率与成本优势，进而提升公司盈利能力。

3、继续加大市场拓展力度，提高市场占有率

在保证产品质量的大前提下，公司将继续实施品牌带动战略，大力拓展市场，巩固和提高国内市场占有率。本次发行募集资金到位后，在尽快投入募集资金投资项目运作的同时，公司将努力寻求新的市场机会，不断完善现有业务产品体系，提高市场占有率，进一步增加公司盈利能力，以更好地回报股东。

4、加快募集资金投资项目建设，提升公司核心竞争力

公司将严格按照董事会及股东会审议通过的募集资金用途，在扣除发行费用后将用于无锡深南电路AI算力电子电路产品项目及补充流动资金。募集资金运用将提升公司生产能力、扩大营收规模，助力公司盈利能力提升。

本次发行募集资金到位后，公司将抓紧进行本次募集资金投资项目的实施工作，积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，实现本次募集资金投资项目的早日投产并实现预期效益，避免即期回报被摊薄，或使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。

5、严格执行现金分红，保障投资者利益

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（［2025］5号）等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

本次发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东回报规划，保障投资者的利益。

（三）相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、控股股东的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东深天科技控股（深圳）有限公司出具了关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：

（1）本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。

（2）自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（3）本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

2、公司董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（3）承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（4）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（5）承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使由董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使公司未来制订的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（本页无正文，为深南电路股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书《董事会关于本次发行的相关声明及承诺》之盖章页）

深南电路股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日